



โครงการ
การเรียนการสอนเพื่อเสริมประสบการณ์

ชื่อโครงการ การสร้างและศึกษาถักกษณะของวัสดุเชิงหวานเดอร์วัลส์ที่ประกอบจาก

โมลิบดีนัมไดซัลไฟร์ด

Fabrication and characterization of van der Waals materials based
on MoS₂

ชื่อนิสิต นางสาวปฐุมพร ชาญเขา เลขประจำตัว 6033421723

ภาควิชา พิสิกส์

ปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พัธม์อุปกรณ์
การสร้างและพัฒนาด้านภาษาและภาษาต่างประเทศที่ประกอบจาก

โมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์

ชื่อนิสิต
นางสาวปฐมพร ชาญเข้า

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ เตชะรนพัฒน์

ภาควิชา
พิสิกส์

ปีการศึกษา
2563

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาสตรีศึกษา ภาควิชาพิสิกส์ คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายงานฉบับนี้แล้ว

Norawee Kancleruk ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรรเวร์ กานญานวัต)

อรุณ พะโน กรรมการสอบ

(อาจารย์ ดร.อรุณพ เอกธารวงศ์)

กานต์ พะโน อาจารย์ที่ปรึกษา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ เตชะรนพัฒน์)

หัวข้อโครงการ	การสร้างและศึกษาลักษณะของวัสดุเชิงแวนเดอร์วัลส์ที่ประกอบจากโมลิบดีนัมไดซัลไฟร์ด
ชื่อนิสิต	นางสาวปฐุมพร ชาญเขา
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ เตชรอนพัฒน์
ภาควิชา	พลังงาน
ปีการศึกษา	2563

บทคัดย่อ

โมลิบดีนัมไดซัลไฟร์ด เป็นวัสดุสองมิติจำพวกโลหะทรานซิชันไดแคลโนเจนไนต์ ซึ่งมีคุณสมบัติคือทนทาน แข็งแรง และยืดหยุ่นได้ดีแต่ยังคงมีขนาดที่เล็ก มีค่าซองว่างแบบพลังงานแบบตรงกันประมาณ 1.8 eV ซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับวัสดุสองมิติอื่น จึงมักจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการแปลงพลังงานและการกักเก็บพลังงาน รวมถึงการใช้งานในพวงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เชิงแสง นอกจากนี้ การนำโครงสร้างที่แตกต่างกันของวัสดุสองมิติมาวางซ้อนกันด้วยแรงแวนเดอร์วัลส์อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการได้ ในงานวิจัยนี้จะทำการสร้างและศึกษาลักษณะของโมลิบดีนัมไดซัลไฟร์ดที่มีแรงแวนเดอร์วัลสมากเกินข้องส่องประการ ประการแรกคือศึกษาสเปกตรัมรามานของโมลิบดีนัมไดซัลไฟร์ดที่ซ้อนกันสองชั้นด้วยมุบบิดเล็กๆ เปรียบเทียบกับแบบหนึ่งชั้นและสองชั้นของโมลิบดีนัมไดซัลไฟร์ด ผลที่ได้คือ ค่าพีคสูงสุดทั้งสองพีคและระยะห่างระหว่างพีคของแบบที่ซ้อนกันด้วยมุบบิดจะมีค่าอยู่ระหว่างโมลิบดีนัมไดซัลไฟร์ดที่เป็นแบบหนึ่งชั้นกับสองชั้น และความเข้มได้จากสองชั้นแบบมุบบิดมีค่าน้อยกว่าที่เป็นสองชั้นปกติแค่เล็กน้อยแสดงให้เห็นว่าถึงแม้จะมีสองชั้นเหมือนกันแต่การปรับเปลี่ยนมุบบิดปรับเปลี่ยนรูปแบบลดลาย (Moiré pattern) ซึ่งจะส่งผลต่อสมบัติบางประการเปลี่ยนแปลงไป ประการที่สองคือศึกษาค่าทางไฟฟ้าของโมลิบดีนัมไดซัลไฟร์ดที่อยู่บนเอกซ์ไกโอนอลโบรอนในไตรด์ โดยสร้างเป็นทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าแล้วจึงนำไปวัดค่าทางไฟฟ้า ซึ่งค่า mobility ของโมลิบดีนัมไดซัลไฟร์ดสามารถวัดได้ประมาณ $2.25 \text{ cm}^2/\text{V.s}$ ที่อุณหภูมิห้อง

Title	Fabrication and characterization of van der Waals materials based on MoS ₂
Name	Pathomphon Chaikhao
Advisor	Asst. Prof. Dr. Thiti Taychatanapat
Major	Physics
Academic year	2563

Abstract

Molybdenum disulfide (MoS₂) is one of the most studied 2D material from family of transition metal dichalcogenides (TMDs). It possesses many fascinating properties such as its high transparency, super strong, durable, flexible, and super thin. Monolayer MoS₂ is a semiconductor with a direct bandgap of 1.8 eV very high compared to other semiconducting 2D materials. All of the aforementioned properties are essential for many applications, such as energy conversion and storage, wearable electronics and optoelectronics. In addition, stacking of 2D materials to create van der Waals heterostructure especially the stacking of two single-layer flakes of MoS₂ may be able to provide new functionalities. In this thesis, we attempt to fabricate and study two type of 2D van der Waals heterostructure based on MoS₂. First, Raman spectrum of twisted bilayer (tMoS₂) is fabricated using pick-up technique and its Raman spectrum is investigated. The peak frequency difference between the two Raman modes of tMoS₂ has a value between single-and bi-layer MoS₂ and the peak intensity of tMoS₂ is lower than that of bilayer MoS₂. This indicates that the tMoS₂ has different characteristics from its single-and bi-layer counterparts. Second, we fabricated field effect transistor from single layer MoS₂/BN van der Waals heterostructure. We measure two-probe electrical conductivity and a function of mobility and find mobility of 2.25 cm²V⁻¹s⁻¹ at room temperature.

กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิจัยฉบับนี้สำเร็จผลลุล่วงไปด้วยดีเนื่องจากผู้ที่ทำวิจัยได้รับความช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิติ เตชะนพัฒน์ ที่ให้การแนะนำ คำปรึกษา ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้มีทักษะในการวิจัยเพิ่มขึ้น ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆมาโดยตลอด ผู้ที่ทำวิจัยขอขอบพระคุณความกรุณาของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอย่างสูง

ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โศกิพงศ์ ฉัตรภรณ์ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ฯ สาลงรัตน์มหาวิทยาลัย ที่ให้ใช้สถานที่และเครื่องมือทำการทดลองต่างๆ

ขอขอบคุณนายอิลเลียส คลานธรักษ์ รุ่นพี่ปริญญาโท ภาควิชาฟิสิกส์ ที่ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา คอยฝึกสอนอย่างใส่ใจในการสอนทุกขั้นตอน เมื่อเจอบัญหาแม้จะได้การช่วยเหลือมาโดยตลอด

ขอขอบคุณนายธีร์โชค ภักรโชค รุ่นพี่ปริญญาเอก ภาควิชาฟิสิกส์ ที่คอยให้ความช่วยเหลือโดยตลอด เครื่องวัดสเปกตรัมราม และคอยตอบคำถามข้อสงสัยต่างๆเสมอมา

ขอขอบคุณคณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ทุกท่านที่ให้ความรู้ คำแนะนำ ฝึกให้มีกระบวนการคิดและสามารถแก้ไขปัญหาได้

ขอขอบคุณรุ่นพี่ และเพื่อนๆ ภาควิชาฟิสิกส์ที่ได้ให้คำแนะนำและช่วยเหลือมาโดยตลอด ทำให้เมื่อเจอปัญหาแต่ละครั้ง ผู้ที่ทำวิจัยสามารถผ่านมันไปได้

ขอขอบคุณทุกคนในครอบครัว ที่คอยส่งกำลังใจมาให้เสมอ รวมทั้งสนับสนุนเรื่องการใช้ชีวิตในรั้วมหาลัย

นางสาวปฐมพร ชาญเชา

นิสิตผู้รับผิดชอบโครงการ

สารบัญ

บทคัดย่อ (ภาษาไทย).....	ii
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ).....	iii
กิตติกรรมประกาศ.....	iv
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์.....	2
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....	3
2.1 โครงสร้างผลึกของโลหะทรานซิชันไดแคโลโคเจนไนด์ และโมลิบดีนัมไดซัลไฟร์ด.....	3
2.2 การวางซ้อนกัน (Stacking).....	4
2.3 Electronic band structure.....	6
2.4 Raman spectra.....	7
2.5 กล้องจุลทรรศน์แรงดึงดูด (Atomic Force Microscope หรือ AFM).....	9
2.6 Electrical	10
2.7 วิธีการสังเคราะห์	11
2.7.1 การลอกจากผลึกโมลิบดีนัมไดซัลไฟร์ด (Mechanical Exfoliation).....	11
2.7.2 วิธีตกเคลือปไอระเหยทางเคมี (Chemical Vapor Deposition หรือ CVD).....	11
2.8 Dry transfer Methods.....	12
2.9 Wet transfer.....	14
2.10 electron beam lithography (EBL).....	15
บทที่ 3 วิธีการทดลอง.....	16
3.1 วัสดุอุปกรณ์.....	16
3.2 ขั้นตอนการทดลอง.....	16
3.2.1 การลอก (exfoliate) โมลิบดีนัมไดซัลไฟร์ด.....	17
- การลอก (exfoliate) โมลิบดีนัมไดซัลไฟร์ด.....	17
- การส่องทางโดยใช้กล้องจุลทรรศน์เชิงแสง (Optical microscope).....	20

3.2.2 การ transfer เพื่อสร้างชีนงานและสร้าง twisted bilayer MoS ₂	21
- การทำ PC polymer stacking.....	21
- วิธีการถ่ายโอนแบบแห้ง (dry transfer method).....	23
- วิธีการถ่ายโอนแบบเปียก (wet transfer method).....	25
3.2.3 ศึกษาคุณสมบัติของโมลิบดีนัมไดซัลไฟร์ด โดยใช้.....	26
- Atomic Force Microscope (AFM) เพื่อดูการจัดเรียงตัว.....	26
- Raman Spectroscopy ของ twisted bilayer MoS ₂	26
- การวัดค่าทางไฟฟ้า (Electrical measurement).....	27
Spin PMMA.....	28
Design etches mask and contact.....	29
Electron Beam Lithography (EBL).....	30
Develop.....	30
Etching with plasma.....	32
Lift-off.....	32
บทที่ 4 ผลการทดลอง.....	34
4.1 การทำชีน MoS ₂	34
4.2 วิธีการถ่ายโอนแบบแห้ง (dry transfer method).....	39
4.2.1 วิธีการเคลื่อนย้ายด้วยแรงวนเดอร์瓦ลส์.....	39
4.2.2 วิธีการเคลื่อนย้ายด้วย PDMS.....	40
4.3 วิธีการถ่ายโอนแบบเปียก (wet transfer method).....	43
4.4 การวัดค่าทางไฟฟ้า (Electrical measurement).....	46
บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผลการทดลอง.....	50
บรรณานุกรม.....	52
ภาคผนวก.....	54

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

สารที่มีโครงสร้างเป็นแผ่นบางที่เชื่อมต่อกันด้วยแรงแวนเดอร์วัลส์ (Van der Waals) ตัวอย่างเช่น กราฟีน (Graphene), ไบرونไนไตรด์ (Boron Nitride) และโลหะทรายชิชันไดแคลโคเจนไนด์ (Transition Metal Dichalcogenides ; TMDs) สารดังกล่าวล้วนมีคุณสมบัติหลายอย่างที่มีความโดดเด่นแตกต่างกัน [1] โดยนับตั้งแต่การค้นพบของกราฟีนในปี 2004 [2] นักวิทยาศาสตร์พยายามมองหาวิธีที่จะนำวัสดุสองมิติอื่นที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้เหนือกว่าอุปกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน หนึ่งในวัสดุที่น่าสนใจคือวัสดุที่เป็นสารประกอบในตระกูลโลหะทรายชิชันไดแคลโคเจนไนด์บางชนิด เช่น โมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ (MoS_2), ทังสเทนไดเซเลไนด์ (WSe_2) ซึ่งเป็นวัสดุสองมิติที่ถูกค้นพบหลังจากกราฟีนแต่ก็ไดรับความสนใจเป็นอย่างมากเช่นกัน

โลหะทรายชิชันไดแคลโคเจนไนด์ (Transition Metal Dichalcogenides ; TMDs) คือสารประกอบอะตอมชั้นเดียวที่มีโครงสร้างแบบ MX_2 โดยที่ M คืออะตอมของโลหะทรายชิชัน และ X คืออะตอมแคลโคเจน ซึ่งยึดติดกันด้วยพันธะเควาเลนต์และระหว่างชั้นจะดูดกันด้วยแรงแวนเดอร์วัลส์ โดยปกติโลหะทรายชิชันไดแคลโคเจนไนด์สามารถมีโครงสร้างแบบพลังงานและสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายหรืออาจมีซึ่งว่างแบบพลังงานแบบไม่ตรงกัน (indirect band gap) [3] แต่โลหะทรายชิชันไดแคลโคเจนไนด์แบบชั้นเดียว (monolayer) นี้จะมีสมบัติคือมีซึ่งว่างแบบพลังงานแบบตรงกัน (direct band gap) ตัวอย่างเช่น โมลิบดีนัมไดซัลไฟด์หนึ่งชั้น มีความหนาประมาณ 0.65 นาโนเมตร มีค่าซึ่งว่างแบบพลังงานแบบตรงกัน 1.8 eV [4] ซึ่งถือว่าสูงมากในวัสดุสองมิติและเมื่อเทียบกับกราฟีนที่ไม่มีค่าซึ่งว่างแบบพลังงาน ด้วยคุณสมบัตินี้ทำให้กราฟีนถูกนำไปประยุกต์ใช้ได้จำกัดแค่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีพลังงานต่ำ ดังนั้นในตอนนี้โมลิบดีนัมไดซัลไฟด์จึงเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการแปลงพลังงานและการกักเก็บพลังงาน รวมถึงการใช้งานในพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ชิ้นแสง สมบัติอีกข้อหนึ่งของโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์คือทนความร้อนได้กว่า 1000 องศาเซลเซียส จึงถือได้ว่าเป็นวัสดุที่ทนทาน แข็งแรง ยืดหยุ่นได้ดีแต่ยังคงมีขนาดที่เล็ก

เมื่อวัสดุสองมิติหนึ่ง RATE ดับอะตอมสองแผ่นมาซ้อนกันยึดติดกันด้วยแรงแวนเดอร์วัลส์ เป็นโครงสร้างแบบ vdW Heterostructure ตัวอย่างเช่นการนำโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์แบบชั้นเดียวสองแผ่นมาวางซ้อนกันโดยที่มุบิดระหว่างแผ่นไม่เป็นศูนย์ (twisted bilayer) จะทำให้ปรากฏลวดลายผลึกที่เรียกว่า “Moiré pattern” โครงสร้างแบบพลังงานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและคุณสมบัติบางประการเปลี่ยนตามไปด้วย โดยขนาดของ Moiré pattern จะขึ้นอยู่กับมุบิดระหว่างชั้นของวัสดุสองมิติ โดยใน twisted bilayer MoS_2 มีการค้นพบว่า เมื่อมุบิดระหว่าง

ซึ่งเป็น 3.5 และ 56.5 องศาค่าความกว้างของແບບພลงงานເວລນໜັ້ນແຄບມາກ [5] ເຖິງປີໄດ້ກັບຄ່າຄວາມກວ້າງຂອງແບບພลงງານຂອງກາຟິນໃນມຸນົບດີເປັນ 1.1 ອົງສາທີ່ເປັນ “magic angle” ດັ່ງນັ້ນທີ່ມຸນົບດີພືເສຍນີ້ twisted bilayer MoS₂ ນີ້ຈ້າງໃຫ້ເກີດສົມບັດໃໝ່ ທີ່ນາສນໃຈເໜືອນທີ່ເກີດໃນ twisted bilayer graphene ເຊັ່ນ strongly-correlated phases, superconductivity ແລະ ferromagnetism ອີກຕ້ວຍ່າງຂອງໂຄຮງສຮ້າງແບບ vdW Heterostructure ຄື່ອ MoS₂/BN heterostructure ຈຶ່ງ BN ທີ່ມີຄວາມບຣິສຸທີ່ ຈະເປັນລົນວຸນໄຟຟ້າທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ກາວວັດສົມບັດທາງໄຟຟ້າດີເກີນ

ໂຄຮງການນີ້ຈະສຮ້າງແລະສຶກຫາຄຸນລັກຂະນະຂອງວັດຖຸເຊີງແວນເດօຮວາລສທີ່ປະກອບຈາກໂມລິບດືນນຳໄດ້ ຂໍ້ລັບໄຟົດສອງລັກຂະນະຄື້ອງ ສຶກຫາສເປັກຕົ້ມຮາມານວັດຖຸເຊີງແວນເດօຮວາລສຈາກ twisted bilayer MoS₂ ເຖິງປີກັບ single layer ແລະ bilayer ແລະສຶກຫາສມບັດທາງໄຟຟ້າຂອງໂມລິບດືນນຳໄດ້ໜ້າໄຟົດທີ່ຍືດຕິດກັບເອກະໂກນອລໂບຮອນໃນໄຕຣດໍດ້ວຍແຮງແວນເດօຮວາລສໂດຍສຮ້າງເປັນທຽບນີ້ສເຕອຣໂດຍໃຫ້ເຕັກນີກທີ່ເຮົາກວ່າ electron-beam lithography (EBL) ຈຶ່ງໂມລິບດືນນຳໄດ້ໜ້າໄຟົດຈະຄຸກເຕີຍມໂດຍໃຫ້ວິຊີກາລົກ (exfoliation) ຮ່ອກາປຸລູກແບບ CVD

1.2 ວັດຖຸປະສົງຂອງໂຄຮງການ

1. ສຮ້າງ twisted bilayer MoS₂ ທີ່ເໜີມສມ ໂດຍວິຊີກາຄ່າຍໂອນແບບແໜ້ງ (dry transfer method) ແລະ ວິຊີກາຄ່າຍໂອນແບບເປີຍ (wet transfer method)
2. ສຶກຫາ Raman spectrum ໃນ twisted bilayer MoS₂ ເຖິງ single-and bi-layer MoS₂
3. ສຮ້າງ MoS₂/BN heterostructure ແລະສື່ຄອນແທດດ້ວຍເຕັກນີກ electron-beam lithography (EBL)
4. ສຶກຫາຄ່າທາງໄຟຟ້າຈາກທຽບນີ້ເຕີອຣໂມລິບດືນນຳໄດ້ໜ້າໄຟົດທີ່ຍືດຕິດກັບເອກະໂກນອລໂບຮອນໃນໄຕຣດໍ

1.3 ປະໂຍບີນທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບ

ກ. ໃນດ້ານຄວາມຮູ້ແລະປະສົບກາຮົນຕ່ອດຕັ້ງນິສິຕ

1. ໄດ້ຝຶກທັກະນະກາໃຫ້ອຸປະກນົນຕ່າງ ຖ້າ ເຊັ່ນ XYR-stage , micromanipulator , optical microscope , temperature control
2. ໄດ້ຝຶກວິເຄຣະທີ່ຂໍອມູນຈາກຜລ AFM, Raman ແລະ Electrical ຂອງ single layer, bilayer ແລະ twisted bilayer MOS₂

ຂ. ຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ນຳໄປສູ່ກາຮົນແກ້ປົງຫາສັງຄມຫົວໜ້າສິ່ງແວດລ້ອມ

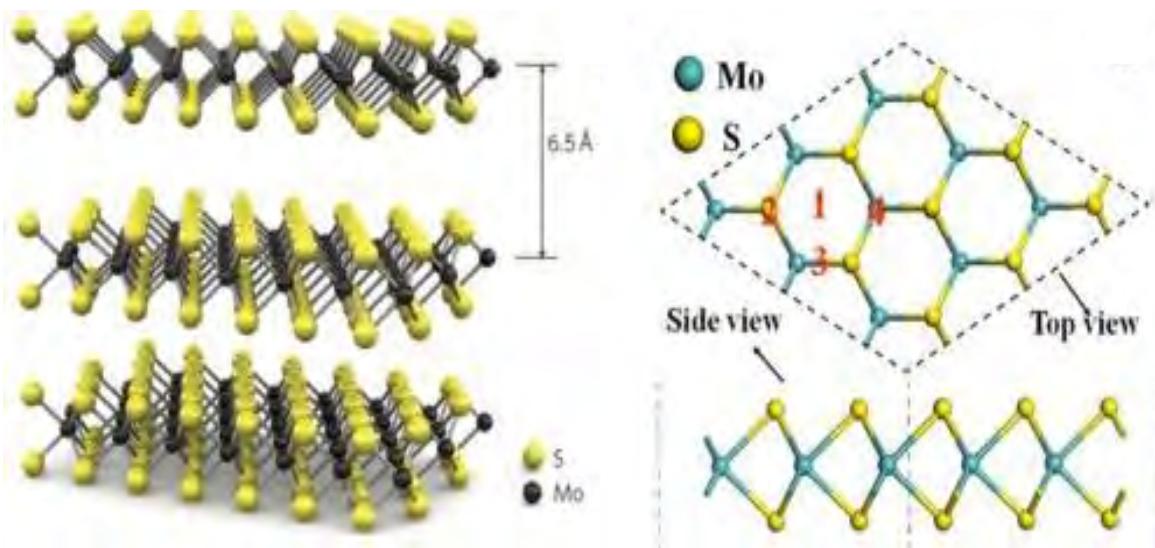
1. ນຳໄປໃຫ້ຕ່ອຍອດໃນອຸປະກນົນອີເລີກທຣອນິກສົມເພື່ອໃຫ້ສາມາຮັດພັ້ນນາອຸປະກນົນອີເລີກທຣອນິກສົມປະສິທິພາພສູງເກີນ

บทที่ 2

ทฤษฎีเกี่ยวข้อง

2.1 โครงสร้างผลึกของโลหะทรานซิชันไดแคลโคเจนไนด์ และโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์^[4]

โลหะทรานซิชันไดแคลโคเจนไนด์ (Transition Metal Dichalcogenides) หรือที่เรียกสั้นๆว่า วัสดุสองมิติ TMDs คือสารประกอบอะตอมชั้นเดียวที่มีโครงสร้างแบบ MX_2 โดยที่ M คืออะตอมของโลหะทรานซิชัน และ X คืออะตอมของแคลโคเจน ซึ่งยึดติดกันด้วยพันธะโควาเลนต์และระหว่างชั้นจะยึดติดกันด้วยแรงแวนเดอร์วัลส์ วัสดุสองมิติ TMD ส่วนใหญ่เป็นพวกราสเตอร์กิงตัวนำ (semiconductor) ที่มีช่องว่างແບ Philippine (bandgap) ครอบคลุมตั้งแต่ช่วงอินฟราเรดไปจนถึงช่วงแสงที่ตามองเห็น และที่เราสนใจคือโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ โดยในโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์จะมี Mo (+4) และ S (-2) เชื่อมต่อกันด้วยพันธะโควาเลนซ์ในรูปของ S-Mo-S โดยปกติหนึ่งชั้นของโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์จะหนาประมาณ 0.65 นาโนเมตร เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติทางการพยาพายที่หลากหลาย เหมาะสมสำหรับการใช้งานตั้งแต่นาโนอิเล็กทรอนิกส์และนาโนโพโตนิกส์ไปจนถึงการตรวจจับและการกระตุ้นในระดับนาโน

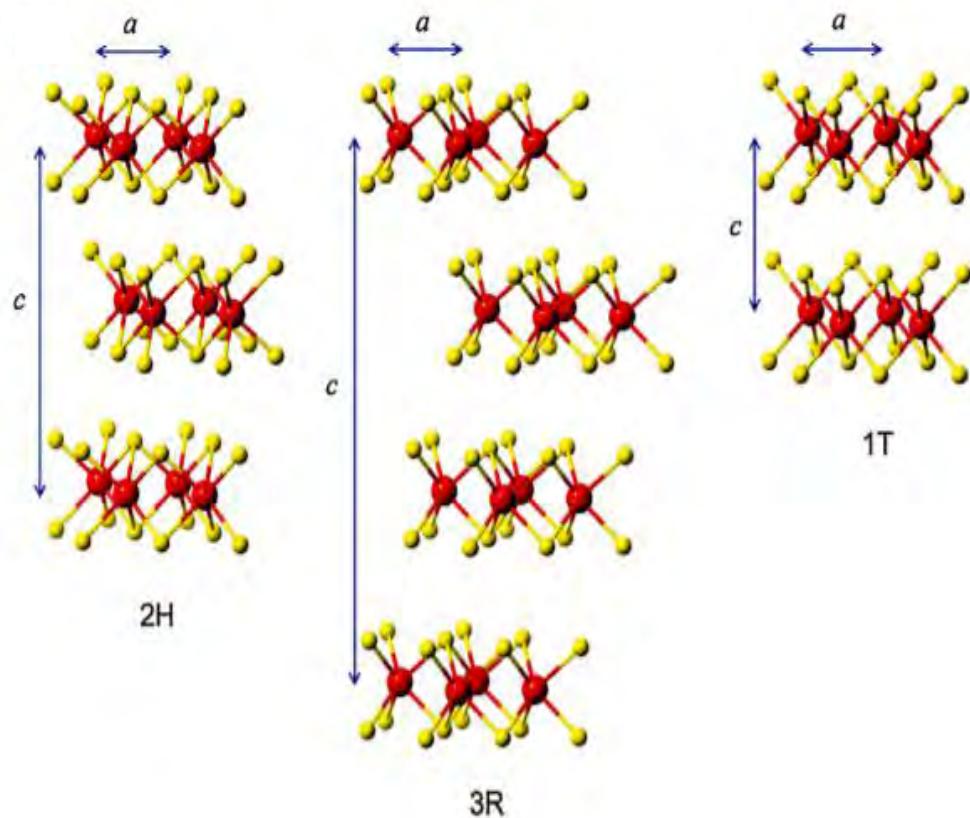


รูปที่ 1 ด้านซ้ายแสดงโครงสร้างสามมิติของโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์หนึ่งชั้นซึ่งมีความหนา 0.65 นาโนเมตร และด้านขวาแสดงโครงสร้างจากด้านบนและด้านข้างของโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์หนึ่งชั้น

ที่มา Z. He, W. Que / Applied Materials Today 3 (2016) 23–5

2.2 การวางซ้อนกัน (Stacking)^{[5],[6]}

การจัดเรียงซ้อนกันของอะตอม โครงสร้างผลึกโมลิบดีนัมไดซัลไฟร์ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ชนิดคือ 1H 1T 2H และ 3R การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนี้จะส่งผลโดยตรงกับคุณสมบัติทางกายภาพ โมลิบดีนัมไดซัลไฟร์ที่เกิดขึ้น เองตามธรรมชาติมักจะเป็นแบบ 2H โดยที่มีการจัดเรียงตัวซ้อนกันของชั้น S-Mo-S ในรูปสมมาตรหกเหลี่ยม (hexagonal Symmetry) หรือปริมาณิดฐานสามเหลี่ยม และในทางกลับกันแบบ 3R ของโมลิบดีนัมไดซัลไฟร์จะมี อะตอมจัดเรียงตัวด้วยรูปสมมาตรสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (rhombohedral symmetry) และแบบเฟส 1T มี สถานะก่อเสถียร (metastable) ที่สามารถพับได้ในโมลิบดีนัมไดซัลไฟร์ชั้นเดียว (single layer)



รูปที่ 2 แสดงโครงสร้างของโมลิบดีนัมไดซัลไฟร์แบบ 2H (ด้านซ้าย) แบบ 3R (ตรงกลาง) และแบบ 1T (ด้านขวา) โดย อะตอมสีแดงคือ Mo และอะตอมสีเหลืองคือ S

ที่มา <https://m.x-mol.com/news/5384?hcb=1&webTitle=xmol.news.webTitle&titleArg1=MoS2>

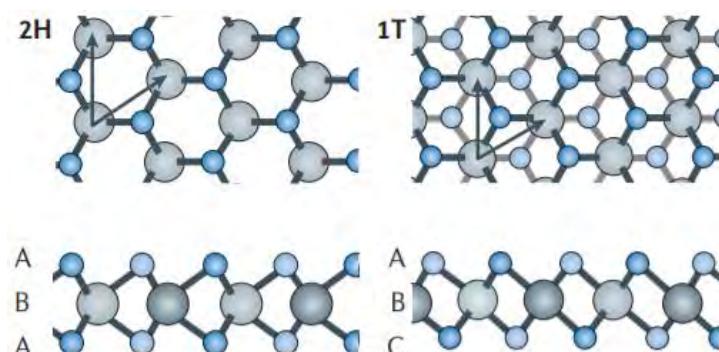
การลอกโดยวิธีการทางเคมีของผลึกแบบ 2H-MoS_2 จะกล่าวไปเป็นแบบกึ่งเส้นยิริ 1T ที่มีหนึ่งชั้นต่อหนึ่งหน่วยเซลล์โดยมีอะตอม Mo จัดเรียงตัวในรูปสมมาตรทรงแปดด้าน (octahedral symmetry) เนื่องจากมันมีความกึ่งเส้นยิริตามธรรมชาติทำให้ 1T สามารถเปลี่ยนเป็นแบบ 2H ได้อย่างง่ายดายเมื่อผ่านการกร่อนภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ



รูปที่ 3 แสดงประเภทของรูปร่างของโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์หนึ่งชั้น คือปริมาณิดฐานสามเหลี่ยม (trigonal prismatic : 2H) และทรงแปดด้าน (octahedral symmetry : 1T)

ที่มา Process Safety and Environmental Protection Volume 118, August 2018, Pages 40-58

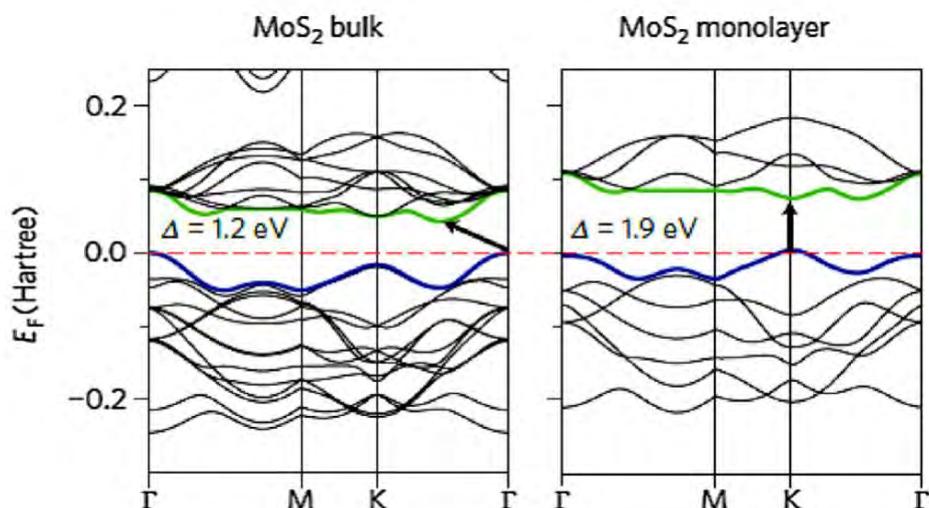
เราสามารถดูรูปแบบโครงสร้างในเทอมของลำดับการเรียงชั้นที่แตกต่างกันของระนาบอะตอมทั้งสาม (แคลโคลเจนเนอร์-โลหะ-แคลโคลเจนไนต์) ของแต่ละชั้นในวัสดุ โดยที่แบบ 2H สอดคล้องกับการเรียงตัวแบบ ABA ที่อะตอมของแคลโคลเจนในด้านขวาของชั้นที่ต่างกันจะอยู่ที่ตำแหน่ง A เดียวกันและตั้งอยู่บนของกันและกันในพื้นที่ตั้งจากกัน และในทางตรงกันข้าม T1 จะมีลักษณะการเรียงตัวเป็นแบบ ABC ที่ในแต่ละระนาบอะตอมจะไม่ตรงกัน



รูปที่ 4 แสดงโครงสร้างอะตอมของของโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์หนึ่งชั้น คือปริมาณิดฐานสามเหลี่ยม (trigonal prismatic : 2H) ที่จะเป็นแบบ AB และทรงแปดด้าน (octahedral symmetry : 1T) ที่จะเป็นแบบ ABC
ที่มา Phys. Rev. Lett. 121, 266401 (2018)

2.3 Electronic band structure^[7]

หนึ่งหรือสองชั้นของโลหะทรานซิชันไดแคลโคเจนไนด์มีค่าช่องว่างແບพลังงานระหว่าง 1 ถึง 2 eV ถึงจะเหมาะสมกับการทำเป็นทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า (Field Effect Transistor หรือ FET) หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ในบรรดา TDMs ทั้งหมด โมลิบเดียมไดซัลไฟฟ์ไดรับความสนใจเนื่องจากมีคุณสมบัติช่องว่างແບพลังงานที่มีทั้งแบบช่องว่างແບพลังงานแบบตรงกัน (direct band gap) และไม่ตรงกัน (indirect band gap) ขึ้นอยู่กับความหนา จากการคำนวณด้วยทฤษฎีฟังก์ชันอคลความหนาแน่น (Density Functional Theory หรือ DFT) เพื่อดูโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของโมลิบเดียมไดซัลไฟฟ์ ช่องว่างແບพลังงานแบบไม่ตรงกันอยู่ระหว่างจุด Γ ถึง Γ -K ใน first brillouine zone มีค่าประมาณ 1.2 eV ในขณะที่ช่องว่างແບพลังงานแบบตรงกันอยู่ในจุด K ค่าประมาณ 1.8-1.9 eV แสดงว่าช่องว่างແບพลังงานแบบไม่ตรงกันจะใหญ่ขึ้นตามจำนวนชั้นที่ลดลง เนื่องมาจาก quantum confinement effect ดังนั้นในหนึ่งชั้นของโมลิบเดียมไดซัลไฟฟ์จะมีช่องว่างແບพลังงานแบบไม่ตรงกันที่ใหญ่มากๆ จนกลายเป็นช่องว่างແບพลังงานแบบตรงกัน เอกลักษณ์ช่องว่างແບพลังงานนี้เองที่สามารถนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในพวกรุ่นต่างๆ

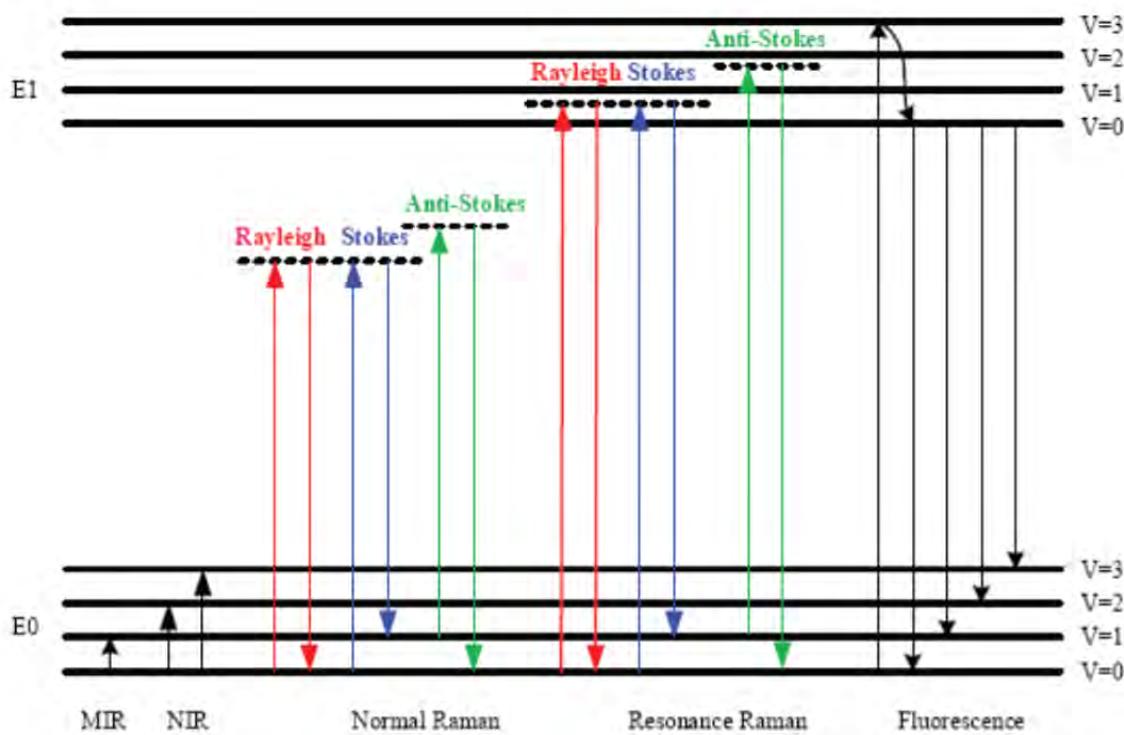


รูปที่ 5 แสดงช่องว่างແບพลังงานของผลึกโมลิบเดียมไดซัลไฟฟ์และโมลิบเดียมไดซัลไฟฟ์แบบชั้นเดียว

ที่มา <https://physics.stackexchange.com/questions/530341/interpretation-of-electronic-band-structure-diagram>

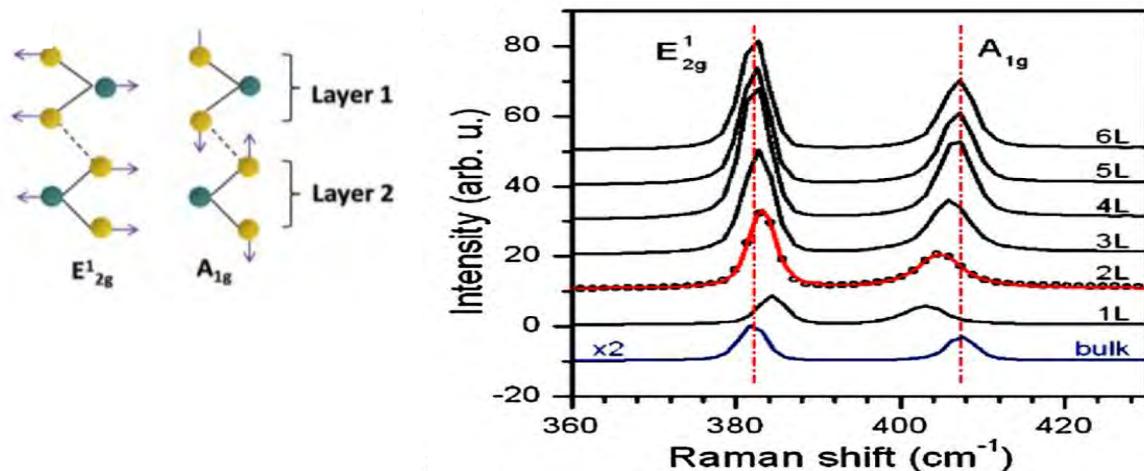
2.4 Raman spectra [8]

Raman spectroscopy เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่อาศัยปรากฏการณ์การกระเจิงแบบรามาน (Raman scattering) ที่เกิดจากอนุภาคแสงเข้าชนโมเลกุลของสาร สมมติให้แสง เลเซอร์ความยาวคลื่นหนึ่งผ่านสารที่ป่องแสง จะมีอนุภาคแสงจำนวนหนึ่งทะลุผ่านไป ขณะที่บางส่วนจะชนเข้ากับโมเลกุลของสารแล้วเปลี่ยนทิศทางในการชนกันนั้น โดยส่วนใหญ่พลังงานหลังจากการชนจะไม่เปลี่ยนแปลง เป็นการชนแบบยึดหยุ่นที่เรียกว่า Rayleigh scattering แต่ก็จะยังมีอนุภาคหลังการชนส่วนน้อยที่มีพลังงานหลังการชนเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนพลังงานกับโมเลกุลของสาร หรือที่เรียกว่าการชนแบบไม่ยึดหยุ่น โดยแสงจะมีความถี่มากขึ้นหรือน้อยลงก็ได้ การเปลี่ยนแปลงหลังการชนนี้เองที่เรียกว่า Raman scattering หากอนุภาคแสงเข้าชนโมเลกุลในสภาพะพื้น ความถี่หลังการชนจะลดลง เรียกว่า Stokes Raman scattering แต่หากอนุภาคแสงเข้าชนโมเลกุลในสภาพะกระตุนความถี่หลังการชนจะเพิ่มขึ้น เรียกว่า Anti-stokes Raman scattering โดยทั่วไปแล้วนิยมวัดการเกิด Stokes Raman scattering เนื่องจากสารจะอยู่ในสภาพะพื้น นอกจากนี้สารแต่ละชนิดจะเปลี่ยนความถี่ของแสงได้แตกต่างกัน และยังให้ความเข้มของแสงที่กระเจิงออกมากไม่เท่ากันอีกด้วย จึงสามารถนำวิธี Raman spectroscopy มาใช้ในการศึกษาโครงสร้างของสารได้



รูปที่ 6 เปรียบเทียบการเปลี่ยนระดับพลังงานของ electron ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ
ที่มา Sensors 2014, 14, 17275-17303; doi:10.3390/s140917275

ในช่วงต้นปี 2010 ได้มีการจำแนกโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ที่หนึ่งชั้นและสองชั้นสามชั้นให้ด้วยรากานสเปกตรัม โดยทั่วไปแล้วจะมียอดของพีครามานหัวไป 2 พีค คือ E_{2g}^1 และ A_{1g} ที่ถูกสะท้อนจากโครงสร้างผลึกของโมลิบดีนัม ไดซัลไฟฟ์ ซึ่งทั้งสองพีคนี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าโหมดการสั่นในระนาบและนอกระนาบทองอะตอม S เป็นอย่างไร ตามลำดับ จากผลึกโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์เปลี่ยนเป็นโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์แบบชั้นเดียวมีการเปลี่ยนแปลงสามอย่าง ด้วยกัน คือ ประการแรก E_{2g}^1 จะแสดง blue-shifted ในขณะที่ A_{1g} แสดง red-shifted ในทิศตรงกันข้าม สำหรับ โมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์แบบชั้นเดียว E_{2g}^1 และ A_{1g} จะอยู่ที่ประมาณ 384 cm^{-1} และ 405 cm^{-1} ตามลำดับ ประการที่สอง ความแตกต่างระหว่างพีค E_{2g}^1 และ A_{1g} แสดงให้เห็นได้จากการลดลงของจำนวนชั้นของโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ โดยระยะห่างความถี่ 25 cm^{-1} สำหรับโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์จำนวนหลายชั้น และ 19 cm^{-1} สำหรับโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์จำนวนชั้นเดียว ประการที่สาม ความเข้มสูงสุดของพีคทั้งสอง E_{2g}^1 และ A_{1g} จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเรียงจากแบบชั้นบางๆ จนถึงสี่ชั้นของโมลิบดีนัมไดวัลไฟฟ์ แล้วจะลดลงเรื่อยๆสำหรับชั้นที่หนากว่านั้น



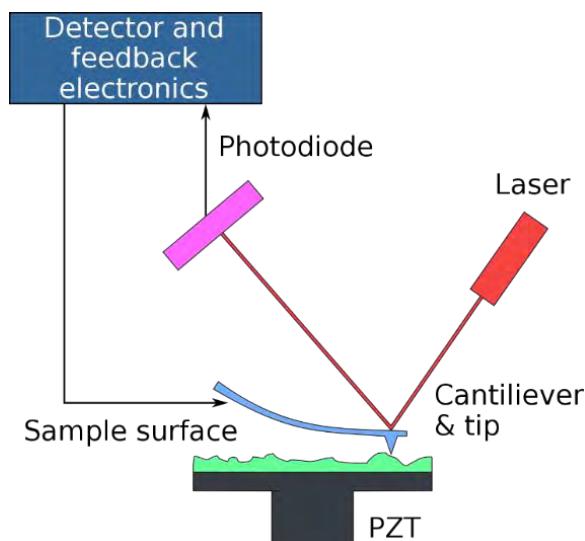
รูปที่ 7 การกระจายจัดของอะตอมในรากานโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ (ซ้าย) รากานสเปกตรัมของโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ที่จำนวนชั้นต่างๆและที่เป็นผลึก (ขวา)

ที่มา ACS Nano 2010, 4, 5, 2695–2700

2.5 กล้องจุลทรรศน์แรงอัตโนม (Atomic Force Microscope หรือ AFM)^[9]

กล้องจุลทรรศน์แรงอัตโนม เป็นกล้องจุลทรรศน์แบบหัวสแกน (Scanning Probe Microscopy หรือ SPM) ประเภทหนึ่งที่สามารถใช้ในการถ่ายภาพวัตถุที่มีขนาดเล็กในระดับนาโนเมตร หรือถ่ายภาพอัตโนมของสารได้ โดยที่กล้อง AFM จะมีลักษณะการทำงานที่พิเศษเฉพาะตัวคือจะใช้หัวอ่านขนาดเล็กวัดแรงผลักและแรงดูดที่เกิดขึ้นระหว่างหัวเข็มกับพื้นผิวของวัตถุ เพื่อมาสร้างเป็นภาพของพื้นผิวของวัตถุนั้นได้ โดยที่กล้อง AFM สามารถนำมาใช้ในการถ่ายภาพขยายในระดับนาโนเมตรของวัตถุที่นำไฟฟ้าและวัตถุที่ไม่นำไฟฟ้า

AFM ใช้ในการตรวจพื้นผิวของวัตถุโดยอาศัยส่วนแขน (cantilever) ที่มีเข็มขนาดเล็ก (tip) ติดอยู่เคลื่อนที่ไปตามพื้นผิวของวัตถุขณะที่มีการยิงแสงเลเซอร์ให้ตกรอบบนส่วนปลายของแขน แสงเลเซอร์จะสะท้อนขึ้นมาสู่เครื่องตรวจวัดความเข้มแสง ดังนั้นถ้าพื้นผิวของวัตถุมีความขรุขระจะทำให้แขนเคลื่อนที่ขึ้ลงและส่งผลให้ความเข้มแสงของแสงเลเซอร์เปลี่ยนแปลงไปด้วย ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงความเข้มแสงนี้จะถูกประมวลโดยคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงผลเป็นภาพพื้นผิวของวัตถุที่ทำการวิเคราะห์ต่อไป

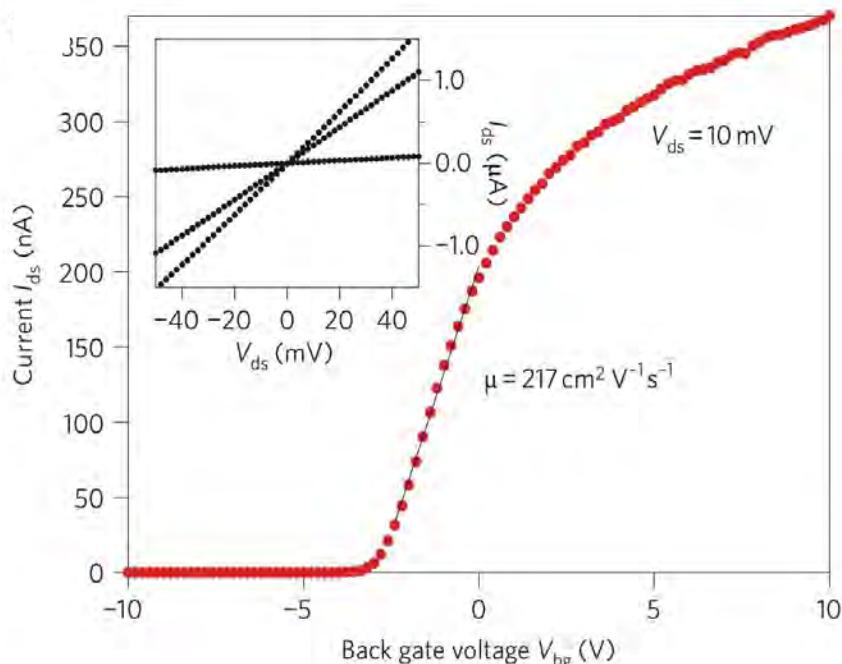


รูปที่ 8 หลักการทำงานของ AFM

ลักษณะชิ้นงานที่ใช้ในการทดสอบ 'ได้แก่' แผ่นฟิล์มบาง คอลลอยด์ อนุภาคนาโนในเครื่องสำอาง เชลล์ แบคทีเรีย ชิ้นงานที่เป็นผงระดับนาโน โดยมีขนาดชิ้นงานไม่เกิน $2 \times 2 \text{ cm}$ หนาไม่เกิน 1 cm ความขรุขระ ไม่เกิน 4 ไมครอน และขนาดภาพสแกนใหญ่ไม่เกิน $100 \times 100 \times 4 \text{ cm}^3$ (กว้าง ยาว สูง) โดยสามารถบอกรากฐานสูงต่ำของพื้นผิวในรูปแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ ซึ่งชิ้นงานของเราจะเป็นโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ที่หนาประมาณ 0.65 นาโนเมตร

2.6 Single-layer MoS₂ transistors [10]

โมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ชั้นเดียวที่มีช่องว่างແບບພลงงานขนาด 1.8 eV เหมาะสำหรับทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ในปี 2018 ได้มีการศึกษาและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ใช้โมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์แบบชั้นเดียวโดยใช้ halfnium oxide เป็น gate dielectric ซึ่งค่า mobility ของโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์สามารถวัดได้อาจสูงถึง $200 \text{ cm}^2/(\text{V.s})$ ที่อุณหภูมิห้องโดยมีอัตราส่วนการเปิด/ปิดกระแส 1×10^8 โดยทั่วไปทราบว่าชั้น MoS₂ ที่ใช้โมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์จะเป็นแบบประเภท n



รูปที่ 9 ศึกษาคุณลักษณะของโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ที่อุณหภูมิห้อง โดยเส้นสีแดงคือกราฟระหว่าง I_{sd} และ V_{bg} ที่ $V_{sd} = 10 \text{ mV}$ และเส้นสีดำคือกราฟระหว่าง I_{sd} และ V_{sd} ที่ $V_{bg} = 0, 1 \text{ และ } 5 \text{ V}$

ที่มา Nature Nanotechnology volume 6, pages147–150(2011)

2.7 วิธีการสังเคราะห์[11]

วิธีการในการสังเคราะห์วัสดุสองมิติมีหลายวิธีด้วยกัน สำหรับโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์วิธีที่ได้รับความนิยมมีสองวิธีคือ

2.7.1 การลอกจากผ้าลีกโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์โดยใช้สก็อตเทปโดยตรง (Mechanical Exfoliation)

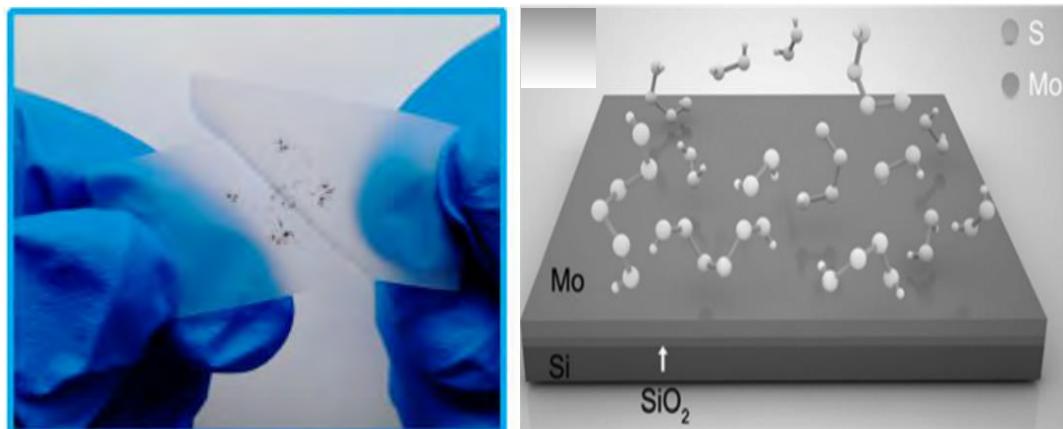
2.7.2 วิธีตกเคลือบไออกซ์เจนทางเคมี (Chemical Vapor Deposition หรือ CVD)

2.7.1 การลอกจากผลึกโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ (Mechanical Exfoliation)

วิธีการลอกชั้นโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ออกจากผลึกจะเป็นวิธีการเดียวกับที่ใช้ในกราฟิน โดยใช้สกอตเทปติดกับผลึกเพื่อลอกโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ออกมากเป็นชั้นๆ ซึ่งเป็นวิธีแรกๆที่มักจะใช้ในการทดลอง เพื่อแยกชั้นของวัสดุสองมิติและลอกช้าๆจนเหลือชั้นเดียว หรือสองถึงสามชั้น วิธีการนี้จะทำให้โมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ที่ได้มีคุณภาพสูง แต่วิธีการนี้จะไม่สามารถควบคุมขนาดและจำนวนชั้นของโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ได้

2.7.2 วิธีติดเคลือบไอระเหยทางเคมี (Chemical Vapor Deposition หรือ CVD)

วิธีการสังเคราะห์โมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ด้วย CVD เป็นการสังเคราะห์ที่อุณหภูมิในช่วง 750-1000 องศาเซลเซียส ลงบนพวกลอยหะทرانซิชัน เช่น Fe, Ru, Co, Ir, Ni, Pd และ Cu เป็นต้น วิธีการสังเคราะห์โมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์บนโลหะหранซิชันด้วยวิธี CVD จะเกี่ยวข้องกับวิธีการทางเคมี โดยกระบวนการนี้เกิดจากการให้ความร้อนแก่โมเลกุลของแก๊สหรือของเหลวที่เป็นแหล่งกำเนิด MoO_3 และ sulfur ทำให้โมเลกุลเกิดการเปลี่ยนเป็นแก๊สที่เป็นสารตั้งต้น โมเลกุลแก๊สหรือไอระเหยของเหลวนี้จะเกิดปฏิกิริยาเมื่อเข้าใกล้แผ่นรองรับที่มีความร้อนและเกิดการแตกตัวและรวมตัวใหม่เป็นวัสดุที่เป็นของแข็งในรูปแบบฟิล์มบางบนแผ่นรองรับ



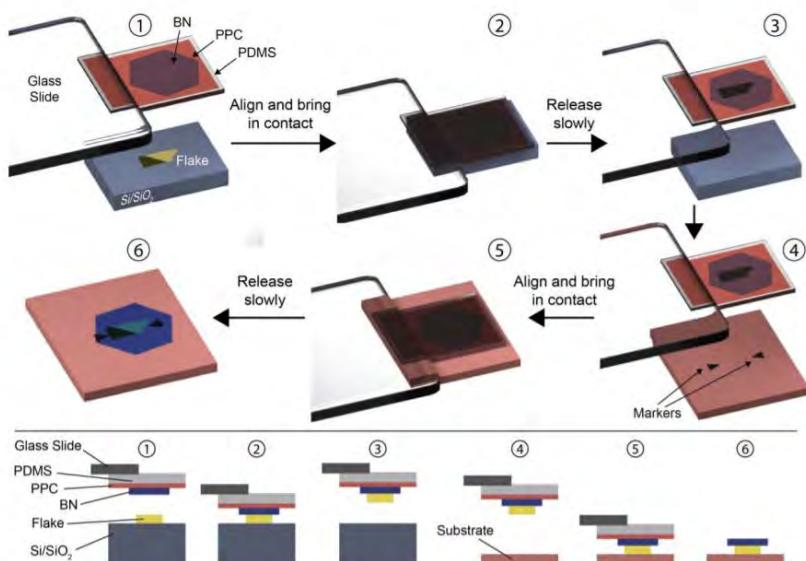
รูปที่ 10 วิธีการลอกชั้นโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ออกจากผลึกในกราฟินโดยใช้สกอตเทป (ด้านซ้าย) และวิธีการสังเคราะห์โมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ด้วยวิธีติดเคลือบไอระเหยทางเคมี (Chemical Vapor Deposition หรือ CVD) (ด้านขวา)

ที่มา http://epgp.inflibnet.ac.in/epgpdata/uploads/epgp_content/S000831ME/P001861/

2.8 Dry transfer Methods^[12]

จากการศึกษาวิธีการเคลื่อนย้ายด้วยแรงแวงเดอร์วัลส์ (van der Waals pick-up transfer Method) คือการใช้อันตรรษียาระงวนเดอร์วัลส์ที่แตกต่างกันของสองพื้นผิวเพื่อถ่ายโอนชิ้นส่วนของวัสดุสองมิติโดยไม่ต้องสัมผัส กับวัสดุสองมิตินั้นโดยตรง แต่จะใช้พอลิเมอร์มาช่วยในการถ่ายโอนแทน นอกจากนี้บางครั้งยังสามารถช่วยลดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนผิววัสดุสองมิติได้อีกด้วย วิธีการคือ ใช้ PDMS ที่ถูกคลุมด้วยชั้นฟิล์มของ polypropylene carbonate หรือ PPC กับไบرونไนเตรต์หากเหลี่ยม (hexagonal boron nitride flake) อยู่ด้านบนในการดึงและถ่ายโอนวัสดุสองมิติที่อยู่บนแผ่นซิลิกอน ซึ่งจะมีวิธีการดังนี้

- 1) นำแผ่นกระเจาที่มี PCC polymer stack ไปยึดกับ micro manipulator เพื่อให้สามารถควบคุมและจัดตำแหน่งได้
- 2) เลื่อน PCC polymer stack ลงอย่างช้าๆจนกระทั่งชิ้น BN ที่อยู่บน PCC polymer stack สัมผัสถักกับชิ้นวัสดุสองมิติที่ต้องการ
- 3) เนื่องจาก BN และวัสดุสองมิติที่ต้องการมีพื้นผิวที่เรียบและสะอาด ทำให้มีแรงแวงวนเดอร์วัลส์ยึดเกาะที่เยื่อมาก จึงสามารถดึงวัสดุสองมิติที่ต้องการออกมากได้โดยการยก PCC polymer stack ขึ้นจากแผ่นรองรับ
- 4) นำ PCC polymer stack ที่มี BN กับวัสดุสองมิตินั้นไปวางบนแผ่นรองรับที่ต้องการ

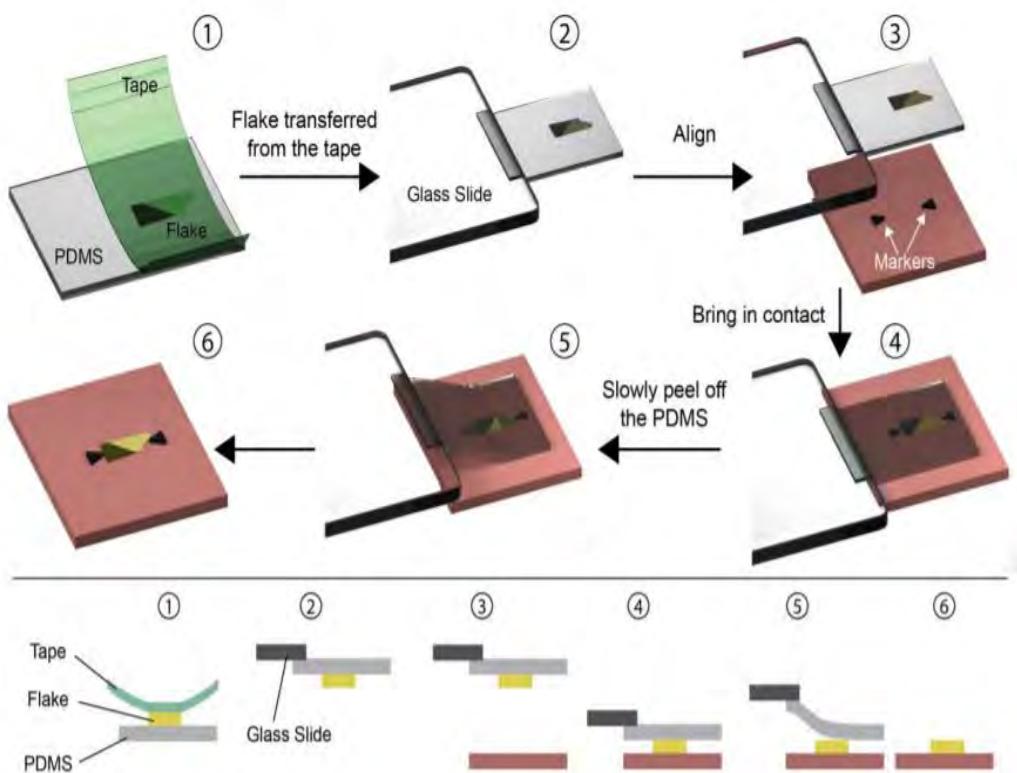


รูปที่ 11 วิธีการเคลื่อนย้ายด้วยแรงแวงวนเดอร์วัลส์ (van der Waals pick-up transfer Method)

ที่มา Chemical Society Reviews 47(1) (2017)

จากการศึกษาวิธีการเคลื่อนย้ายด้วย PDMS (polydimethylsiloxane) โดยจะต้องเตรียมชิ้นของวัสดุสองมิติก่อน โดยใช้วิธีการ exfoliation ด้วยสกอตเทปสีฟ้าลงบน PDMS stamp จะทำให้ได้ชิ้นวัสดุสองมิติที่ต้องการติดอยู่บน PDMS นั้น จากนั้นนำถ่านและจะมีวิธีการดังนี้

- 1) PDMS stamp ที่มีวัสดุสองมิติ จะถูกนำไปวางบน glass slide และถูกนำไปเย็บกับ micro manipulator
- 2) ดูผ่านกล้องจุลทรรศน์เพื่อดูตำแหน่งของวัสดุสองมิติที่ต้องการที่อยู่บน PDMS ให้ตรงกับตำแหน่งแผ่นรองรับที่ต้องการอย่างแม่นยำ
- 3) หมุน micro manipulator ลงให้พิวของวัสดุสองมิติที่อยู่บน PDMS stamp และพิวของแผ่นซิลิกอนสัมผัสนั้นสุด
- 4) ยก glass slide ขึ้นอย่างช้าๆ ในลักษณะที่ให้ PDMS ค่อยๆ หลุดออกจากอย่างนุ่มนวลจากแผ่นรองรับเพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศ

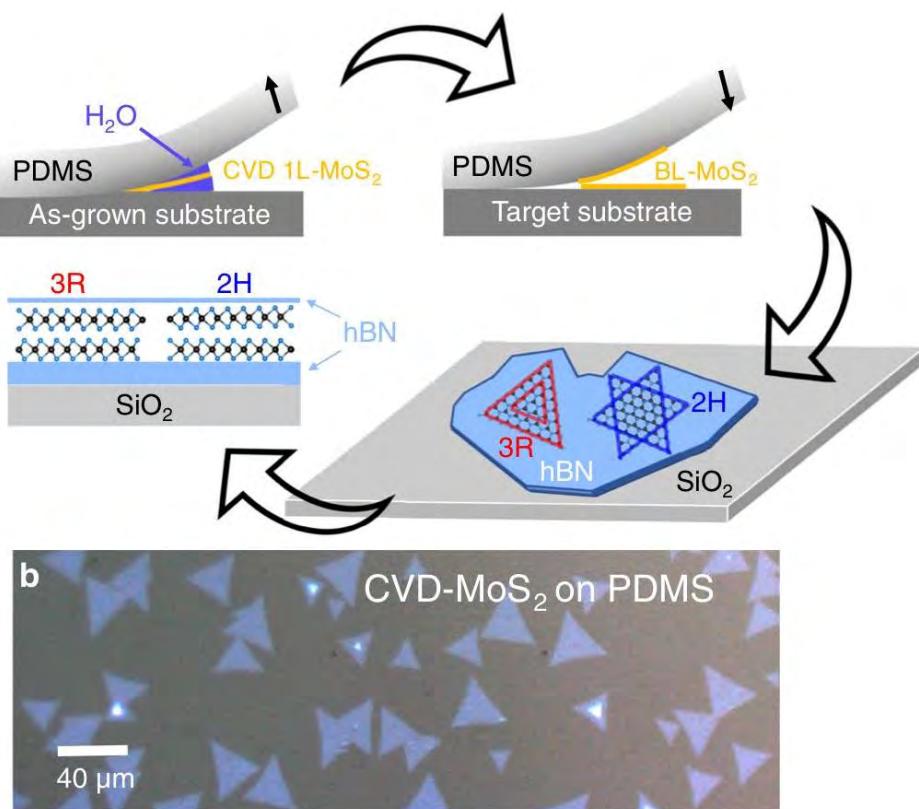


รูปที่ 12 วิธีการเคลื่อนย้ายด้วย PDMS

ที่มา Chemical Society Reviews 47(1) (2017)

2.9 Wet transfer^[13]

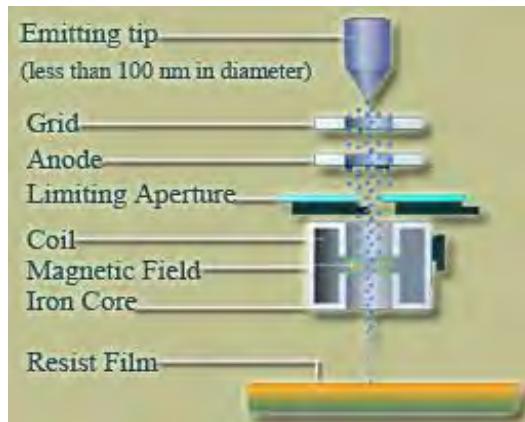
จากการศึกษาการใช้วิธีการที่เรียกว่า water-assisted deterministic transfer พบว่าสามารถเคลื่อนย้ายโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยวิธีตากเคลือบไฮโรเทยาทางเคมี (CVD) ได้เป็นอย่างดี โดยจะทำให้โมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ไปอยู่บน PDMS โดยใช้น้ำหนydลงไประหว่างผิวสัมผัส PDMS กับผิวสัมผัสของแผ่นรองรับที่มีโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์จากวิธีการ CVD ก่อนที่จะนำไป PDMS ที่มีโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์นี้ไปวางช้าๆ บนแผ่นรองรับที่เป็นซิลิกอนที่มี hBN อยู่



รูปที่ 13 วิธีการเคลื่อนย้ายด้วยน้ำ
ที่มา Nature Communications 11, Article number: 2391 (2020)

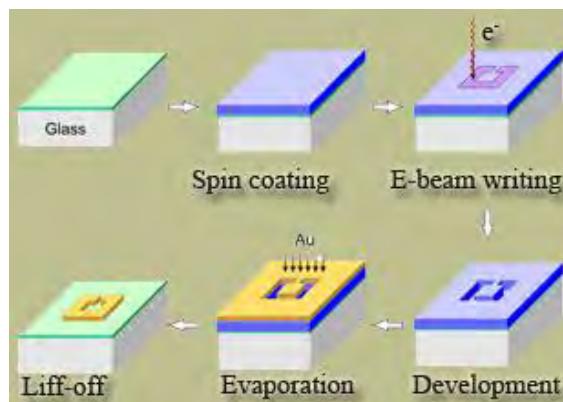
2.10 electron beam lithography (EBL)^[14]

electron beam lithography (EBL) เป็นวิธีการสร้างโครงสร้างระดับนาโนโดยการใช้ลำอนุภาคอิเล็กตรอนจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เพื่อสร้างแบบแพทเทิร์นอย่างละเอียดบนพื้นผิวตั้งต้น ซึ่งวิธีการนี้ถูกนำมาใช้มากในอุตสาหกรรมการสร้างแพทเทิร์นไฟฟ้าในปัจจุบัน



รูปที่ 14 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่ถูกนำมาใช้ในการสร้างโครงสร้างนาโนโดยวิธีการ EBL ที่มา <https://il.mahidol.ac.th/e-media/nano/Page/Unit4-4.html>

หลักการทำงาน คือ ใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมการปล่อยลำอนุภาคอิเล็กตรอน (โดยต้องให้แคบลงในระดับนาโนเมตร) ลงสู่พื้นผิวของวัตถุ ซึ่งเป็นพื้นผิวที่ถูกเคลือบด้วยฟิล์มบางตามแบบแพทเทิร์นที่ได้ออกแบบไว้ (อาจจะเป็นพื้นผิวของพลัติเมอร์) ทำให้เกิดร่องรอยการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวที่ได้เคลือบไว้ จากนั้นก็ทำการระเหยอนุภาคที่ต้องการเพื่อเคลือบและใช้เป็นโครงสร้างนาโน จากนั้นก็จะนำหั้งส่วนที่ระเหยไปเคลือบแล้วกำจัดส่วนที่เคลือบด้วยฟิล์มบางออก สุดท้ายก็จะได้โครงสร้างนาโนตามแบบที่ได้กำหนดไว้โดยลำอนุภาคอิเล็กตรอน ซึ่งการสร้างโครงสร้างนาโนที่เกิดขึ้นนี้จะมีความแม่นยำสูง และวิธีการนี้สามารถนำไปใช้ได้กับหลากหลายพื้นผิวสัตว์อีกด้วย



รูปที่ 15 ขั้นตอนการทำงานตามวิธีการของ EBL ที่มา <https://il.mahidol.ac.th/e-media/nano/Page/Unit4-4.html>

บทที่ 3 วิธีการทดลอง

3.1 วัสดุอุปกรณ์

- แผ่นซิลิโคน (Silicon wafer)
- ผ้ามุลberry ดีนัมไดซัลไฟร์ธรรมชาติ (Natural MoS₂) และ MoS₂ CVD
- เฮกซะโนโนลไบرونไนโตรด (Hexagonal boron nitride: BN)
- เทปสีฟ้าสำหรับลอกวัสดุสองมิติ (Blue tape)
- Tweezers (ปลายเป็นยางและพลาสติก), Glass slide และ Plastic petri dish
- ฟอร์เซป (forceps)
- กล้องจุลทรรศน์เชิงแสง (Optical microscope) สำหรับการส่องหา MoS₂ และ BN
- PDMS mold (pre-polymer และ curing agent)
- Polypropylene carbonate (PCC) in anisole
- Plasma cleaning และ Heating plate
- กล้องจุลทรรศน์เชิงแสง (Optical microscope) สำหรับ transfer
- XYR-stage, micro manipulator และ temperature controller
- Anisole, Acetone และ IPA alcohol
- Spin coating machine และเครื่องปั๊มอากาศ (Air pump)

3.2 ขั้นตอนการทดลอง

ขั้นตอนที่ 1 การลอก (exfoliation) โมลิบดีนัมไดซัลไฟร์

- การลอก (exfoliation) โมลิบดีนัมไดซัลไฟร์ให้ได้ชั้นบางๆ โดยการใช้แผ่นสก็อตเทปป์ไปมา แล้วนำมาร่ายในลงบนแผ่นซิลิโคนที่มีขนาดประมาณ 1 ตารางเซนติเมตร
- ศึกษาโครงสร้างโมลิบดีนัมไดซัลไฟร์คร่าวๆ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง รวมทั้งบันทึกตำแหน่งของโมลิบดีนัมไดซัลไฟร์เป็นพิกัด 2 มิติ

ขั้นตอนที่ 2 การ transfer เพื่อสร้างชิ้นงานและสร้าง twisted bilayer MoS₂ นำโมลิบดีนัมไดซัลไฟร์ 2 แผ่น มาประกอบกันโดยใช้ PC polymer stacking ด้วยวิธีการ “Pick-up method” และ โดยวิธีการถ่ายโอนแบบแห้ง (dry transfer method) และใช้ PDMS ด้วยวิธีการถ่ายโอนแบบเปียก (wet transfer method)

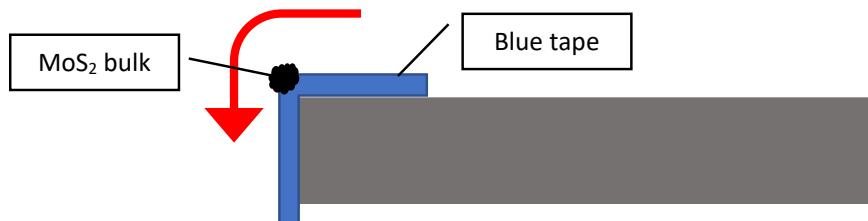
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาคุณสมบัติของโมลิบดีนัมไดซัลไฟร์ โดยใช้

- Atomic Force Microscope (AFM) เพื่อดูความหนาและพื้นผิวของโมลิบดีนัมไดซัลไฟร์
- Raman Spectroscopy ของ single layer, Bilayer และ twisted bilayer MoS₂
- การอุกแบบและการวัดค่าทางไฟฟ้า (Electrical measurement)

3.2.1 การลอก (exfoliation) โมลิบดีนัมไดซัลไฟร์

การลอก (exfoliation) โมลิบดีนัมไดซัลไฟร์

1. ใช้ tweezers หยิบผลึกโมลิบดีนัมไดซัลไฟร์ธรรมชาติโดยเลือกด้านที่มีความเจ้าทั้งแผ่นไปวางไว้บน เทปสีฟ้าที่มีความกว้างประมาณ 2-3 ซม. จากนั้นใช้ฟอร์เซปกดเบาๆเพื่อผลักให้ติดกับเทปสนิท โดย เทคนิคคือ หลังจากแบปลึกลอกโมลิบดีนัมไดซัลไฟร์ลงไปแล้ว ให้เลื่อนเทปผ่านขอบโต๊ะช้าๆ เพื่อให้ชั้นของโมลิบดีนัมไดซัลไฟร์ลอกออกจากผลึก จากนั้นใช้ฟอร์เซปคีบผลึกโมลิบดีนัมไดซัลไฟร์ส่วน ที่ไม่ติดกับเทปเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไป



รูปที่ 16 แสดงเทคนิคการใช้ขอบโต๊ะในการช่วยลอกผลึกโมลิบดีนัมไดซัลไฟร์แห่งทั่วไปบนเทป ซึ่ง จะใช้เทปนี้เป็น mother tape สำหรับการลอกในแต่ละครั้ง

2. พับเทปประกอบกันไปมาโดยพยายามอย่าให้ทับบริเวณเดิมจนโมลิบดีนัมไดซัลไฟร์แห่งทั่วไปบนเทป ซึ่ง จะใช้เทปนี้เป็น mother tape สำหรับการลอกในแต่ละครั้ง

3. ใช้เทปสีฟ้าที่มีความกว้างประมาณ 2-3 ซม. อีกอันมาลอกโนลิบดีนัมไดชัลไฟฟ์จาก mother tape โดยค่อยๆ แปลงเทปลงไปช้าๆ ให้เรียบสนิทและไม่ให้เกิดฟองอากาศ แล้วค่อยๆ ลอกเทปออกจากกันช้าๆ ด้วยความเร็วคงที่ จากนั้นพักไว้เพื่อไปเตรียมแผ่นรองรับ ในที่นี้คือแผ่นซิลิกอน และ PDMS

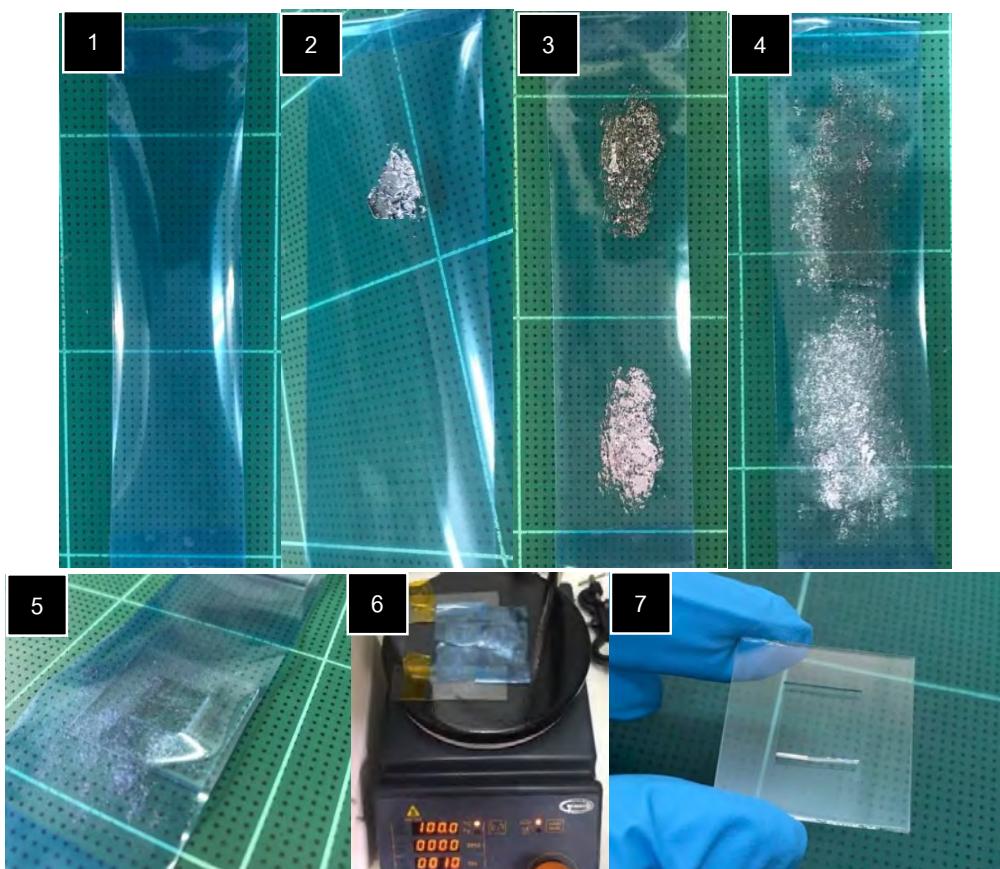


รูปที่ 17 ผลึกโนลิบดีนัมไดชัลไฟฟ์ธรรมชาติ (ซ้าย) แผ่นซิลิกอน (กลาง) และ PDMS mold (ขวา)

4. วิธีการเตรียมแผ่นรองรับมี 2 แบบคือแผ่นซิลิกอน และ PDMS
 - 4.1 แผ่นซิลิกอน: นำแผ่นซิลิกอนที่ตัดเป็นแผ่นรูปร่างสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด $1 \times 1 \text{ cm}^2$ ไปเป่าไลา ผุ่นที่ผิวน้ำของแผ่นซิลิกอนด้วยปืนลมไนโตรเจน จากนั้นนำไปทำการสะละด้วย O₂ Plasma เป็นเวลา 10 นาที
 - 4.2 PDMS: นำ PDMS mold ที่เตรียมไว้มาตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด $1 \times 1 \text{ cm}^2$ จากนั้นนำไปวางบนกระจุก Glass slide
5. ลอกเทปในข้อ 3. ออกจาก mother tape จากนั้นเทปที่มีผลึกโนลิบดีนัมไดชัลไฟฟ์ธรรมชาติแผ่อยู่ทั่ว น้ำไปแปลงบนแผ่นรองรับที่เตรียมไว้ในข้อ 4. โดยการนำ tweezers ปลายพลาสติกแตะเบาๆ จนทั่ว แผ่น จากนั้นใช้ยางลบกดเทปที่แปบบนแผ่นซิลิกอนโดยทิ้งน้ำหนักลงไปที่ข้อมือหรือปลายนิ้วที่ใช้กด เพื่อไล่ฟองอากาศเป็นเวลา 1 นาที
6. นำเทปที่แปบบนแผ่นรองรับนี้ไปให้ความร้อน 100°C เป็นเวลา 2 นาที แล้วทิ้งไว้ให้เย็น 5 นาที จากนั้นจึงค่อยๆ ทำการดึงเทปออก โดยการดึงจะต้องทำอย่างช้าๆ และความเร็ว慢ๆ เสมอ
7. นำแผ่นรองรับที่มีชิ้นโนลิบดีนัมไดชัลไฟฟ์ไปเก็บใน petri dish และตั้งชื่อ MOS₂(01), MOS₂(02),.... จากนั้นนำไปเก็บในตู้ดูความชื้น

หมายเหตุ

- สำหรับการลอก BN บนแผ่นซิลิกอนก็ใช้วิธีการคล้ายการลอกโนโลจิบดีนัมไดซัลไฟฟ์บันแผ่นซิลิกอน แต่จะต่างกันตรงขั้นตอน 3 จะนำแผ่นซิลิกอนที่ตัดเป็นแผ่นรูปร่างสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด $1 \times 1 \text{ cm}^2$ ไปเป่าไส่ผู้นั่งที่ผิวน้ำของแผ่นซิลิกอนจากนั้นนำไปทำการให้ความร้อน 100°C เป็นเวลา 10 นาที แทนการใช้ O_2 Plasma cleaning
- สำหรับ mother tape แต่ละอันสามารถนำไปใช้ต่อจนกว่าโนโลจิบดีนัมไดซัลไฟฟ์บันเทปจะขาด ซึ่งใช้ได้ประมาณ 3 ครั้ง



รูปที่ 18 ขั้นตอนการลอก (exfoliation) โนโลจิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ด้วยสกอตเทป (1) ตัดเทบสีฟ้าที่มีความกว้างประมาณ 2-3 ซม.(2) นำผลึกโนโลจิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ธรรมชาติไปวางไว้บนเทบสีฟ้า (3) พับเทปประกอบกันไปมาโดยพยาามอย่าให้หักที่เดิม (4) จนโนโลจิบดีนัมไดซัลไฟฟ์แผ่ทั่วเทบสีฟ้า (5) นำเทปที่มีผลึกโนโลจิบดีนัมไดซัลไฟฟ์แผ่อยู่ทั่วไปแบบลงบนแผ่นรองรับ (6) นำเทปที่ແປบนแผ่นซิลิกอนนี้ไปให้ความร้อน 100°C เป็นเวลา 2 นาที (7) ค่อยๆ ทำการดึงเทปออกจะมีชิ้นบางๆ ของผลึกโนโลจิบดีนัมไดซัลไฟฟ์อยู่บนแผ่นรองรับ

การส่องหาโดยใช้กล้องจุลทรรศน์เชิงแสง (Optical microscope)

1. นำชิลิกอนหรือ PDMS ไปวางบน stage ของกล้องจุลทรรศน์เชิงแสง จากนั้นทำการบันทึกค่าตำแหน่งเริ่มต้น (set origin) ที่มุมล่างซ้ายของแผ่น
2. ปรับกำลังขยายไปที่ 200 เท่า และทำการส่องหา จากซ้ายไปขวาจนสุดแล้วขยับบนขึ้นนิดหนึ่งและส่องจากขวาไปซ้ายไล่ไปเรื่อยๆ จนเจอชิ้น MoS₂ หรือ BN ที่เหมาะสม
3. เมื่อทำการเจอชิ้น MoS₂ หรือ BN ที่เหมาะสมให้ปรับกำลังขยายของเลนส์ไกล์วัตตุไปที่ 1000 เท่า เพื่อคุณภาพเยี่ยดให้เยื่อชิ้น จากนั้นทำการถ่ายรูปชิ้น MoS₂ หรือ BN ด้วยกำลังขยาย 1000, 500, 200, 100, 50 เท่าตามลำดับ พร้อมตั้งชื่อรูปที่ถ่าย และบันทึก coordinates ของชิ้น MoS₂ หรือ BN
4. ส่องจนทั่วแผ่นชิลิกอนหรือ PDMS
5. นำค่าตำแหน่งที่ได้ไปสร้างกราฟตำแหน่งบนชิลิกอนเพื่อให้จ่ายต่อการเลือกชิ้น MoS₂ หรือ BN ที่เหมาะสม

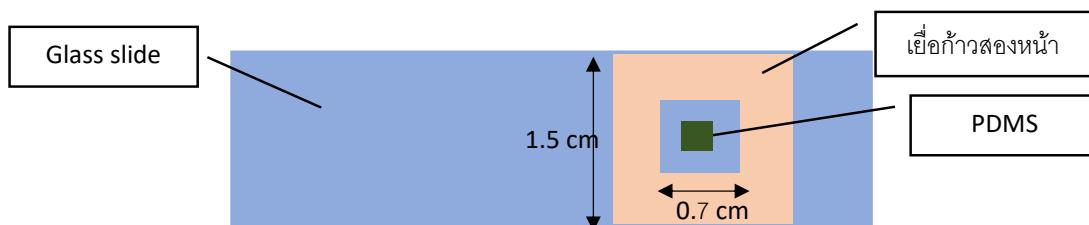
หมายเหตุ

การส่องบน PDMS จะส่องที่กำลังขยาย 500 เท่าแทน เนื่องจากแผ่นรองรับมีการโปร่งแสงและ MoS₂ ความหนาหนึ่งชั้นบางมากและมีความโปร่งแสง

3.2.2 การ transfer เพื่อสร้าง twisted bilayer MoS₂

การทำ PC polymer stacking

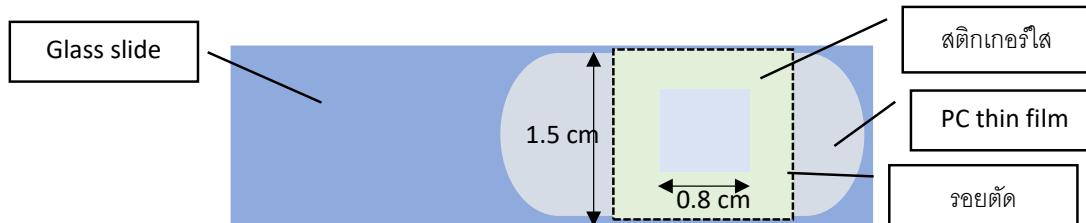
- การเตรียม PDMS mold ทำได้โดยการนำ PDMS pre-polymer ซึ่งเป็นของเหลว ผสมกับ curing agent ในอัตราส่วน 10:1 ใส่ไว้ในจานเพาะเชื้อ (petri dish) ที่ล้างสะอาดด้วย acetone และ IPA ให้สะอาดที่สุดจนไม่เหลือคราบօร์ปราภูมิอยู่ หลังจากนั้นพัก PDMS mold ที่ไว้ให้แข็งตัว 2 คืน ในตู้สุญญากาศ (ในขณะพักจะทำการปั๊มอากาศออกตลอดเวลาเพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศหลังจากการแข็งตัวแล้ว)
- การเตรียม PC ทำได้โดยการใส่ chloroform ใน PC ด้วยอัตราส่วน 6% ของสารละลายโดยมวลหรือ ผสม PC : chloroform ด้วยอัตราส่วน 1 : 0.064 ไว้ในบีกเกอร์ จากนั้นใช้แม่เหล็กคนสารโดยใช้ประมาณความเร็ว 200-250 rpm (ปิดด้วยพาราฟิล์มเพื่อไม่ได้สารระเหย) จากนั้นคนทิ้งไว้ข้ามคืน หรือจนกว่าจะละลายเข้ากันหมด แล้วนำไปเก็บไว้ให้ชวดสีชา
- นำ PDMS mold ที่เตรียมไว้ในข้อ 1. มาตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด $0.4 \times 0.4 \text{ cm}^2$ จากนั้นนำไปวางบนกระดาษ Glass slide ที่มีเยื่อการสองหน้าขนาด $1.5 \times 1.5 \text{ cm}^2$ ซึ่งมีรูตรงกลางขนาดประมาณ $0.7 \times 0.7 \text{ cm}^2$ (ขนาดใหญ่กว่า PDMS)



รูปที่ 19 แสดงขั้นตอนการตัดเยื่อการสองหน้าขนาดประมาณ $1.5 \times 1.5 \text{ cm}^2$ และตัดช่องตรงกลางขนาดประมาณ $0.7 \times 0.7 \text{ cm}^2$ ไปวางบน glass slide จากนั้นวาง PDMS ไว้ตรงกลาง

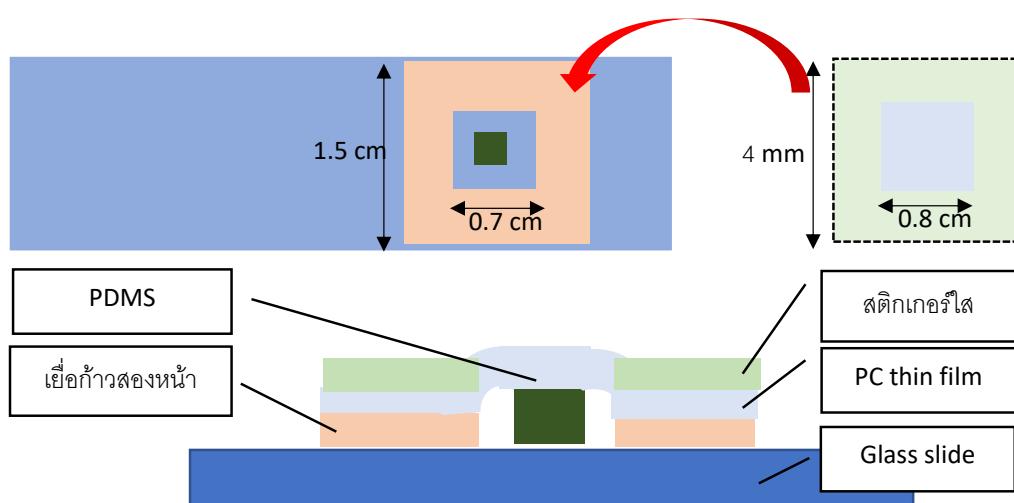
- หยด PC ในข้อ 2. ประมาณ 2 หยด บน glass slide เป็นๆแล้วใช้ glass slide อีกแผ่นปัดให้เบน และเรียบที่สุดที่จะเป็นไปได้ (เป็นพิล์มบาง PC) เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาจากการหักเหของแสงผ่านกล้อง จุลทรรศน์ขณะสร้างชั้นงาน และทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 15 นาที

5. นำสติกเกอร์ใส่ตัดเป็นสี่เหลี่ยมขนาด $1.5 \times 1.5 \text{ cm}^2$ ซึ่งมีรูทรงกลางขนาดประมาณ $0.8 \times 0.8 \text{ cm}^2$ (ใหญ่กว่า PDMS) ไปติดฟิล์มบาง PC บน glass slide ในข้อที่ 4 จากนั้นใช้คัตเตอร์กรีดตามรอยสติกเกอร์ ลอกออกอีกมาแค่ส่วนของฟิล์มบางที่ติดกับสติกเกอร์ใส่อย่างช้าๆ อย่าให้ฟิล์มขาด



รูปที่ 20 แสดงขั้นตอนการตัดสติกเกอร์ใสขนาดประมาณ $1.5 \times 1.5 \text{ cm}^2$ และตัดช่องตรงกลางขนาดประมาณ $0.8 \times 0.8 \text{ mm}^2$ ไว้รองบนฟิล์มบาง PC

6. จากนั้นนำพิล์มบาง PC ที่ตีดึงด้วยสติกเกอร์ใสไปวางบน PDMS ที่อยู่บน glass slide พยายามอย่าให้พิล์มยับ และลงภายในครั้งเดียวจะได้ PC polymer stacking



รูปที่ 21 แสดงรูปด้านข้างของ PC polymer stack

หมายเหตุ

- ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าตู้สูญญากาศที่ใช้วาง PDMS mold ขนาดกับพื้นเพื่อที่จะได้ PDMS ที่มีความหนาสม่ำเสมอ
- ทุกขั้นตอนเพื่อความมั่นใจว่าจะไม่มีผุนผงไปติดที่ PDMS mold สามารถเปิดด้วยปืนลมในโตรเจนได้
- การทำ PDMS mold ควรจะแน่ใจว่าแข็งตัวสนิทก่อนที่จะตัด

วิธีการถ่ายโอนแบบแห้ง (dry transfer method)

สำหรับลอก MoS₂ บนแผ่นรองรับที่เป็นซิลิกอน

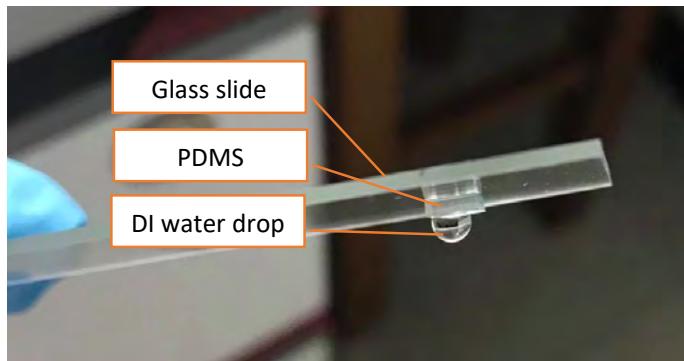
1. นำแผ่นซิลิกอนที่มีชิ้น BN ไปวางบน transfer stage
2. เลื่อนตำแหน่งของชิ้น BN ที่ต้องการจาก coordinate ที่บันทึกไว้ให้ เมื่อเจอปรับจนภาพในกล้องจุลทรรศน์ชิงแสงชัดที่สุด และอยู่ตรงกลางพอดี
3. นำแผ่นกระจก (glass slide) ที่ได้ทำ PC polymer stack ไว้เป็นคู่กับ micro manipulator
4. ปรับอุณหภูมิ stage โดยใช้ temperature controller ไปที่ 100 องศาเซลเซียส
5. ใช้ micro manipulator เลื่อนให้ PC ลงไปบนแผ่นซิลิกอนบริเวณชิ้น BN (Top BN) อย่างช้า ๆ เพื่อให้ BN ยึดติดกับ PC
6. เมื่อ PC ทับจนทั่ว BN ให้ใช้ micro manipulator เลื่อน PC ขึ้นจากแผ่นซิลิกอนอย่างรวดเร็ว (ไม่ให้เกิดฟองอากาศขณะดึงขึ้นและเพื่อเพิ่มแรงกระชาก) จะทำให้ชิ้น BN ติดกับ PC ขึ้นมา (จะสังเกตเห็นว่าชิ้น BN ติดขึ้นมากับ PC จากกล้อง โดยจะเห็นว่าชิ้น BN นั้นหายไปจากแผ่นซิลิกอนแล้ว)
7. นำ PC ไปส่องกล้องจุลทรรศน์เพื่อดูลักษณะ BN ที่ติดขึ้นมาและความเสียหายของ PC
8. ย้ายแผ่นซิลิกอนอันเดิมออก จากนั้นนำแผ่นซิลิกอนที่มีชิ้น MoS₂ มาวางบน stage แทน
9. เลื่อนตำแหน่งของชิ้น MoS₂ ให้ไปชี้ในกลางภาพของกล้องจุลทรรศน์ชิงแสง
10. เลื่อนตำแหน่งของ BN บน PC ให้ตั้งกับ MoS₂ บนแผ่นซิลิกอน
11. ใช้ micro manipulator เลื่อน BN บน PC ให้ทับลงไปบนแผ่นซิลิกอนของ MoS₂ อย่างช้า ๆ (ควรให้ฟองอากาศหมดก่อนที่จะเลื่อนลงต่อไป)
12. ใช้ micro manipulator เลื่อนให้ชิ้น BN บน PC ขึ้นจากแผ่นซิลิกอนอย่างรวดเร็ว (ไม่ให้เกิดฟองอากาศขณะดึงขึ้นและให้เพิ่มแรงกระชาก) เพื่อให้ชิ้น MoS₂ ติดกับ PC ขึ้นมา (จะสังเกตเห็นว่าชิ้น MoS₂ ขึ้นมากับ PC จากกล้อง โดยการดูว่าชิ้น MoS₂ นั้นหายไปจากแผ่นซิลิกอนแล้ว) แสดงว่าตอนนี้มี MoS₂/BN อยู่บน PC
13. ย้ายแผ่นซิลิกอนอันเดิมออก จากนั้นนำแผ่นซิลิกอนที่มีชิ้น BN (Bottom BN) มาวางบน stage แทน
14. เลื่อนตำแหน่งของ MoS₂/BN บน PC ให้ตั้งกับ BN (Bottom BN) บนแผ่นซิลิกอน
15. ใช้ micro manipulator เลื่อน MoS₂/BN บน PC ทับลงบนแผ่นซิลิกอนของ BN (Bottom BN) อย่างช้า ๆ พอกไกลับบริเวณที่เป็น MoS₂ ให้ค่อยๆ เพิ่มอุณหภูมิจนถึง 180 องศา และค่อยๆ เลื่อน micro manipulator ให้ช้าที่สุดเพื่อให้ PC ละลายติดอยู่กับแผ่นซิลิกอน แสดงว่าตอนนี้มี BN/MoS₂/BN อยู่บนแผ่นซิลิกอน

16. จากนั้นนำแผ่นชิลิกอนไปแข่ anisole และล้างด้วย acetone และ IPA ตามลำดับ
สำหรับการลอก MoS₂ บนแผ่นรองรับที่เป็น PDMS
1. นำแผ่นชิลิกอนที่มีชิ้น BN ไปวางบน transfer stage
 2. เลื่อนตำแหน่งของชิ้น BN ให้ไปขึ้นในกลางภาพของกล้องจุลทรรศน์เชิงแสง
 3. ตัด PDMS ที่ทำการลอก MoS₂ ไว้ขนาดประมาณ $0.4 \times 0.4 \text{ cm}^2$ โดยให้เลือกตัดแค่บริเวณที่มี single layer MoS₂ ที่ต้องการ จากนั้นนำไปวางบน glass slide
 4. นำ MoS₂/PDMS บน glass slide ที่เตรียมไว้ในข้อ 3. ไปยึดกับ micro manipulator
 5. ปรับอุณหภูมิ stage โดยใช้ temperature controller ไปที่ 70 องศาเซลเซียส
 6. เลึงตำแหน่งของ MoS₂ บน PDMS ให้ตรงกับ BN บนแผ่นชิลิกอน
 7. ใช้ micro manipulator เลื่อน PDMS ลงบนแผ่นชิลิกอนบริเวณชิ้น BN อย่างช้าๆ เพื่อให้ MoS₂ ติด กับ BN บนแผ่นชิลิกอน
 8. ทิ้งไว้ประมาณ 1 นาทีค่อยเลื่อน PDMS ขึ้นมาช้าๆ ด้วยความเร็วคงที่จะได้ MoS₂/BN อยู่บนแผ่น ชิลิกอน
 9. นำ PDMS บน glass slide ที่เตรียมไว้ในข้อ 3. อีกชิ้นนึงไปยึดกับ micro manipulator
 10. เลึงตำแหน่งของ MoS₂ บน PDMS ให้ตรงกับ MoS₂/BN บนแผ่นชิลิกอน
 11. หมุน stage ให้ขอบด้านใดด้านหนึ่งของ MoS₂ ที่อยู่บนชิลิกอนตรงกับขอบของ MoS₂ บน PDMS
 12. หมุน stage ไปอีก 3.5 องศาเพื่อให้ได้ twisted ที่มุ่นน้อยๆ
 13. ใช้ micro manipulator เลื่อน PDMS ลงบนแผ่นชิลิกอนบริเวณที่มีชิ้น MoS₂/BN อย่างช้าๆ เพื่อให้ MoS₂ ติดกับ MoS₂/BN บนแผ่นชิลิกอน
 14. ทิ้งไว้ประมาณ 1 นาทีค่อยเลื่อน PDMS ขึ้นมาช้าๆ ด้วยความเร็วคงที่ จะได้ twisted MoS₂/BN อยู่ บนแผ่นชิลิกอน

วิธีการถ่ายโอนแบบเปียก (wet transfer method)

วิธีการนี้จะหมายกับวิธีตกลเคลือบไประเหยทางเคมี (Chemical Vapor Deposition หรือ CVD)

1. ตัด PDMS mold ขนาดประมาณ $0.4 \times 0.4 \text{ cm}^2$ ไปวางบน glass slide
2. หยดน้ำ DI 1 หยดบน PDMS ที่อยู่บน glass slide (หยดน้ำจะเกาะอยู่บน PDMS)



รูปที่ 22 แสดงหยดน้ำที่เกาะอยู่บน PDMS

3. นำ PDMS บน glass slide ที่มีหยดน้ำเกาะไปยึดกับ micro manipulator
4. นำแผ่นซิลิกอน MoS₂ ที่ปลูกด้วยวิธี CVD ไปวางบน transfer stage
5. เลื่อนตำแหน่งของ MoS₂ ให้ไปขึ้นในกลางภาพของกล้องจุลทรรศน์เชิงแสง
6. เลื่อนตำแหน่งของหยดน้ำให้อยู่บริเวณที่ต้องการให้ MoS₂ บนแผ่นซิลิกอนติดกับ PDMS ขึ้นมา
7. ใช้ micro manipulator เลื่อนให้ PDMS ลงบนแผ่นซิลิกอนอย่างช้า ๆ จนสุดที่จะลงໄປได้ จากนั้นจึงค่อยๆ เลื่อนขึ้นด้วยความเร็วเท่ากับตอนลง จะเห็นว่ามี MoS₂ ติด PDMS ขึ้นมา
8. นำ PDMS ที่มี MoS₂ ไปวางลงบนแผ่นซิลิกอนเปล่าๆ ที่ 70 องศา
9. ใช้ PDMS ทำซ้ำข้อ 2.-7. อีกชั้น จากนั้นนำไปเลึงให้ตรงกับ MoS₂ ที่อยู่บนซิลิกอนในข้อ 8.
10. หมุน stage ให้ขอบด้านใดด้านหนึ่งของ MoS₂ ที่อยู่บนซิลิกอนตรงกับขอบของ MoS₂ บน PDMS
11. หมุน stage ไปอีก 3.5 องศาเพื่อให้ได้ twisted ที่มุนน้อยๆ
12. ใช้ micro manipulator เลื่อนให้ PDMS ลงบนแผ่นซิลิกอนบริเวณที่มีชิ้น MoS₂ อย่างช้า ๆ เพื่อให้ MoS₂ ติดกับ MoS₂ บนแผ่นซิลิกอน
13. ทิ้งไว้ประมาณ 1 นาทีค่อยเลื่อน PDMS ขึ้นมาช้าๆ ด้วยความเร็วคงที่ จะได้ twisted MoS₂ อยู่บนแผ่นซิลิกอน

3.2.3 ศึกษาคุณสมบัติโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)

Atomic Force Microscope (AFM)

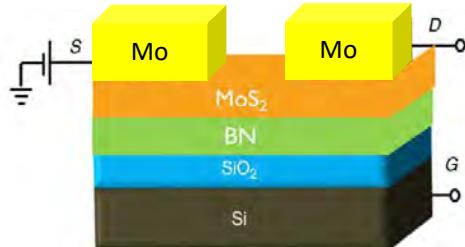
สามารถใช้ในการวิเคราะห์ความเรียบและความหนาของพื้นผิวของโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ นอกจากนี้เพื่อให้ง่ายต่อการออกแบบ etch mask และคอนแทคและหลิกเลี่ยงบริเวณที่มีฟองอากาศหรือสิ่งสกปรกสำหรับในขั้นตอนการใส่คอนแทค

Raman Spectroscopy

เราใช้การวัดค่ารามานในการวิเคราะห์จำนวนขั้นซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. วางแผ่นซิลิโคนที่มีชิ้นงานที่ต้องการวัดลงบน glass slide ที่อยู่บน stage
2. ปรับไฟกัสภาพขยายที่กำลังขยายเลนส์ใกล้วัตถุ 10x ที่ขอบล่างซ้ายให้ชัด (เราจะใช้ขอบล่างซ้ายเป็นจุดอ้างอิงเมื่อมีการส่องชิ้นโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ในกล้องจุลทรรศน์เชิงแสง) จากนั้นกด set zero เพื่อให้ตำแหน่งขอบล่างซ้ายนี้เป็นตำแหน่ง (0,0)
3. ใส่พิกัดของชิ้นงานที่เคยบันทึกไว้ในขั้นตอนการส่องชิ้นโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ในกล้องจุลทรรศน์เชิงแสง จากนั้นปรับกำลังขยายเลนส์ใกล้วัตถุเป็น 100x และปรับไฟกัสภาพละเอียดให้ได้ภาพที่มีความชัดมากที่สุด
4. เลื่อนให้จุดที่ต้องการจะวัดอยู่ตรงกลางของกากบาทซึ่งเป็นเลเซอร์สีเขียว จากนั้นทำการบันทึกภาพหน้าจอเพื่อให้เราทราบตำแหน่งที่เราใช้วัดที่แน่นอนหลังจากวัดค่าสเปกตรัมรามานอกรอบมา ต้องระวังตอนปรับไฟกัสภาพละเอียด เพราะเลนส์ใกล้วัตถุจะอยู่ใกล้ชิ้นงานของเราเป็นอย่างมากจึงควรค่อยๆ หมุนทีละนิด
5. เปลี่ยนโหมดจาก visualizing mode (ปิดแสงจากกล้อง) ไปที่ Raman mode (เปิดแสงเลเซอร์) โดยเราจะใช้เลเซอร์สีเขียวซึ่งมีความยาวคลื่น 532 นาโนเมตรที่มีความเข้มสูงสุด ใส่ค่า accumulation times และ ค่า repeating count ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความเข้ม (intensity) ไม่สูงเกินไป
6. ทำซ้ำข้อ 4.-5. แต่เปลี่ยนเป็นพิกัดอื่นใกล้ๆ กัน เพื่อเปรียบเทียบว่าข้อมูลที่ได้ ซึ่งไม่ควรต่างกันมาก หากมีจำนวนชั้นเท่ากันและเป็นแบบเดียวกัน
7. นำข้อมูลอกรอบมาเป็นไฟล์นามสกุลต่างๆ ที่จำเป็นมากคือ text file ที่จะนำไปplotグラฟในโปรแกรม IGOR

การวัดค่าทางไฟฟ้า (Electrical measurement)



รูปที่ 23 แสดงให้เห็นการต่อวงจรอย่างง่ายของทรานซิสเตอร์ nano ไฟฟ้าจากโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์

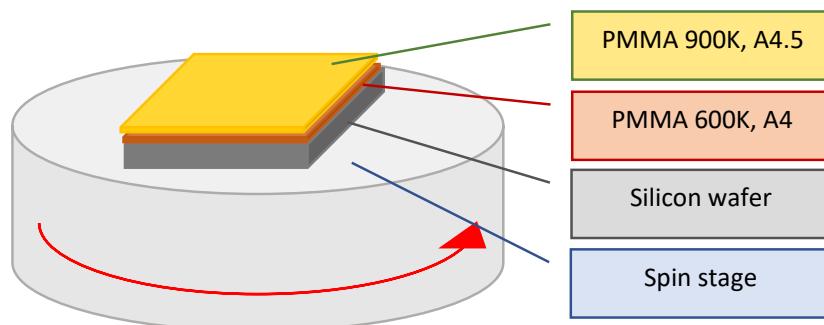
ก่อนที่จะนำไปใช้ค่อนແຕկเพื่อวัดค่าทางไฟฟ้า จะเป็นต้องทำให้ผิวของชิ้นงานที่จะวัดมีความเรียบ หรือเลือกแคบบริเวณที่เรียบมาใช้ในการวัดจะถึงขั้นตอนการวัดมีวิธีการทำชิ้นงานหนึ่งชิ้น เป็นขั้นตอนดังนี้

- 1.) Spin PMMA เตรียมพื้นผิว ก่อนใช้ EBL
- 2.) Electron Beam Lithography (EBL) สร้างลวดลายของ Marker Field
- 3.) Develop เป็นขั้นตอนที่เอา PMMA ส่วนที่เป็นลวดลายของ Marker Field ออก
- 4.) Marker Deposition and sputtering Mo ใส่ Mo ไปแทนที่ส่วนที่โดน Develop ออก
- 5.) Lift-off เอา PMMA และ Mo ส่วนที่ไม่ใช่ลวดลายของ Marker Field ออก
- 6.) Design etch mask เพื่อออกแบบบริเวณที่ต้องการใช้งานและบริเวณที่ต้องการกำจัด
- 7.) Spin PMMA เตรียมพื้นผิว ก่อนใช้ EBL
- 8.) Electron Beam Lithography (EBL) ลวดลายของ Etch mask ที่ออกแบบไว้ข้อ 5
- 9.) Develop เป็นขั้นตอนที่เอา PMMA ส่วนที่เป็นลวดลายของ Etch mask ออกซึ่งคือส่วนของโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ที่เราไม่ต้องการเก็บไว้
- 10.) Etching with plasma กำจัดส่วนของโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ที่เราไม่ต้องการเก็บไว้
- 11.) แช่ acetone และ IPA เอา PMMA ที่เหลือทั้งหมดออก
- 12.) Design contact เพื่ออกรูแบบคอนแทคในการวัดตามต้องการ
- 13.) Spin PMMA เตรียมพื้นผิว ก่อนใช้ EBL
- 14.) Electron Beam Lithography (EBL) ลวดลายของ contact ที่ออกแบบไว้ข้อ 12
- 15.) Develop เป็นขั้นตอนที่เอา PMMA ส่วนที่เป็นลวดลายของ contact ออก
- 16.) Marker Deposition and sputtering Mo ใส่ Mo ไปแทนที่ส่วนที่โดน Develop ออก
- 17.) Lift-off เอา PMMA และ Mo ส่วนที่ไม่ใช่ลวดลายของ contact ออก
- 18.) วัดค่าทางไฟฟ้า

Spin PMMA

การเคลือบพอลิเมอร์จำพวกพอลิเมทิลเมทาคริเลต (Poly Methyl Methacrylate ,PMMA) ลงบนแผ่นรองรับที่มีชิ้นงานอยู่เพื่อช่วยในการรักษาบริเวณที่ต้องการวัด และกำจัดบริเวณที่ไม่ต้องการรวมถึงการสร้างเป็นคุณแทคโดย lithography และการ sputtering Mo

- ให้ความร้อนแผ่นซิลิกอนที่มีชิ้นงานที่จะวัดอยู่ที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาทีเพื่อไอล์ฟ์แลและไม่เลกุลของแก๊สที่อยู่บนผิวของแผ่นซิลิกอน
- เมื่อครบ 5 นาทีให้รีบนำแผ่นซิลิกอนมาวางแท่นวางบนเครื่องสปิน เปิดเครื่องปั๊มเพื่อดูดแผ่นซิลิกอนไว้กับแท่นวาง จนนั้นนำไปเปตต์พลาสติกหยด PMMA ขนาด 600K ,A4 ให้ทั่วแผ่นซิลิกอน รีบกดสปินเป็นสองช่วงที่ 500 RPM เป็นเวลา 5 วินาที และตามด้วย 4000 RPM เป็นเวลา 60 วินาที หากสังเกตการเปลี่ยนสีจะพบว่า PMMA จะมีการเปลี่ยนสีในช่วงวินาทีที่ 40 ของการสปินช่วงที่ 2
- ให้ความร้อนแผ่นซิลิกอนที่มีชิ้นงานที่จะวัดอยู่ที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาทีเพื่อระเหยตัวทำละลายในพิล์ม PMMA และเพิ่มแรงยึดติดระหว่างพิล์ม PMMA กับแผ่นซิลิกอน
- เมื่อครบ 5 นาทีให้รีบนำแผ่นซิลิกอนมาวางแท่นวางบนเครื่องสปิน เปิดเครื่องปั๊มเพื่อดูดแผ่นซิลิกอนไว้กับแท่นวาง จนนั้นนำไปเปตต์พลาสติกหยด PMMA ขนาด 900K ,A4.5 ให้ทั่วแผ่นซิลิกอน รีบกดสปินเป็นสองช่วงที่ 500 RPM เป็นเวลา 5 วินาที และตามด้วย 6000 RPM เป็นเวลา 60 วินาที หากสังเกตการเปลี่ยนสีจะพบว่า PMMA จะมีการเปลี่ยนสีในช่วงวินาทีที่ 42 ของการสปินช่วงที่ 2

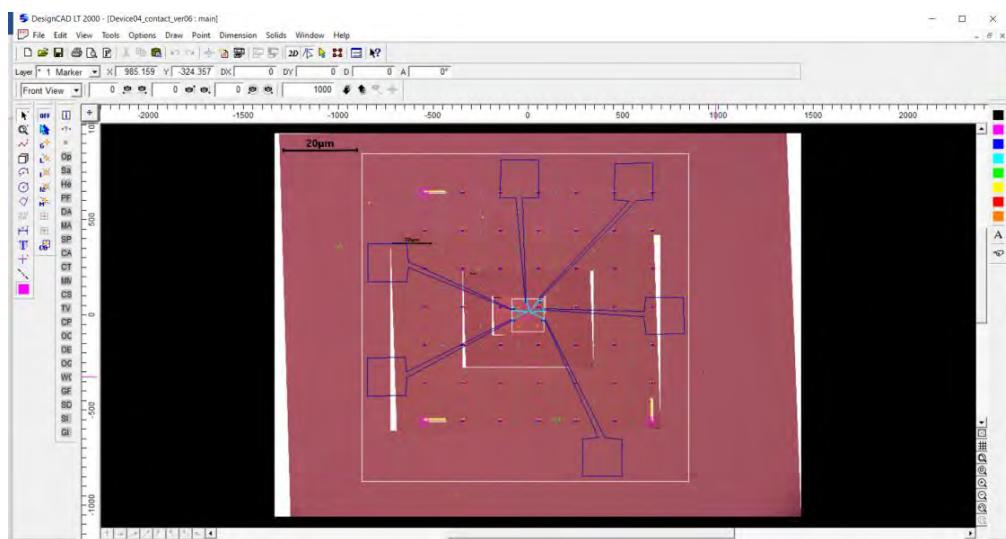


รูปที่ 24 แสดงชั้นของ PMMA ที่สปินลงบนแผ่นซิลิกอน

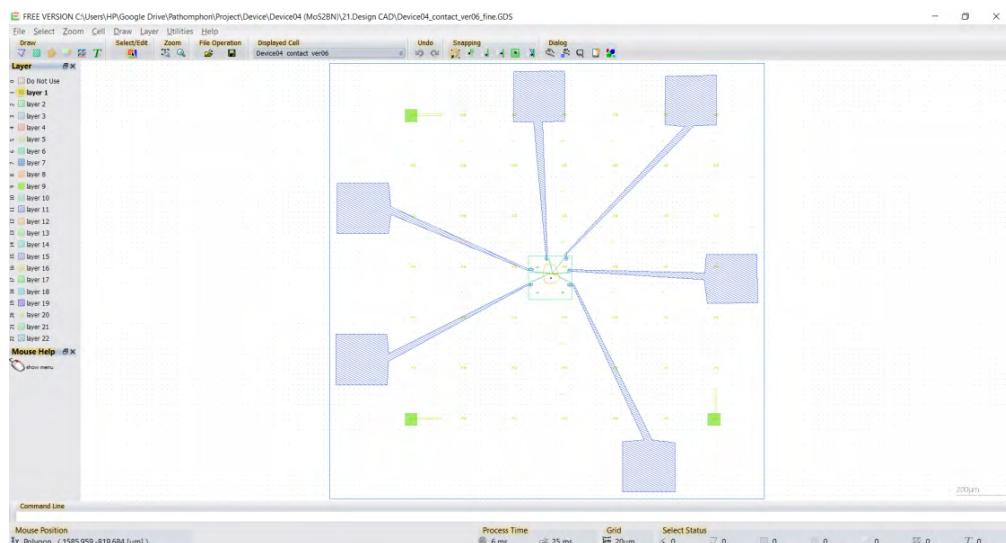
- ให้ความร้อนแผ่นซิลิกอนที่มีชิ้นงานที่จะวัดอยู่ที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาทีเพื่อระเหยตัวทำละลายในพิล์ม PMMA และเพิ่มแรงยึดติดระหว่างพิล์ม PMMA กับแผ่นซิลิกอน
- ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนำไปส่องกล้องเพื่อดูความเรียบ ถ้าหากพิล์ม PMMA ไม่เรียบโดยเฉพาะบริเวրที่มีชิ้นงาน ควรล้าง PMMA ออกแล้วทำใหม่

Design etches mask and contact

โปรแกรมที่จะใช้สำหรับการออกแบบ etch mask และคอนแทคคือ Design CAD โดยวิธีการคือเราจะนำรูปทุกกำลังขยายมาวางช้อนกันและทำการปรับรูปทุกกำลังขยาย 50 ,100 ,200 ,500 และ 1000 เพื่อให้สเกลของ maker field ของรูปจากกล้องจุลทรรศน์เชิงแสงตรงกับสเกลของ maker field ที่ออกแบบไว้ในโปรแกรมให้ได้มากที่สุด จากนั้นจึงทำการออกแบบบริเวณที่ต้องการยิงด้วยลำแสงอิเล็กตรอน และทำการ output ข้อมูลออกมาด้วยโปรแกรม layout editor เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ในขั้นตอน EBL ได้



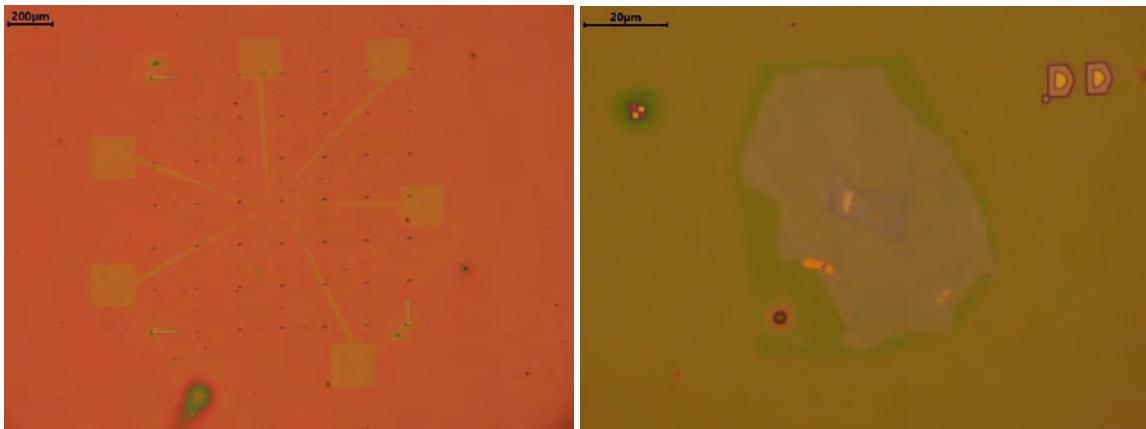
รูปที่ 25 แสดงตัวอย่างการออกแบบคอนแทคในโปรแกรม Design CAD



รูปที่ 26 แสดงตัวอย่างการ output ข้อมูลด้วยโปรแกรม layout editor

Electron Beam Lithography (EBL)

การสร้างลวดลายด้วยเทคนิค Electron Beam Lithography (EBL) ลงบนแผ่นซิลิโคนที่เคลือบด้วยพิล์ม PMMA เพื่อการสร้าง ออกแบบ และผลิตชิ้นงานที่มีโครงสร้างในระดับนาโนเมตร ซึ่งลวดลายที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามที่เราได้ออกแบบไว้ใน Design CAD



รูปที่ 27 ลวดลายของคอนแทค (ซ้าย) และของ etch mask (ขวา) หลังจากการใช้สำโนเล็กตرونยิง

Develop

โดยปกติการ develop จะมีอยู่ 2 วิธีคือที่อุณหภูมิห้องและที่อุณหภูมิต่ำ ในที่นี่เราจะใช้การ develop ที่อุณหภูมิต่ำ โดยวิธีการคือ

1. ผสมสารที่เรียกว่า developer คือ DI water : IPA = 1 : 3 โดยจะใส่น้ำ DI 20 มิลลิลิตร จากนั้นเติม IPA อีก 60 มิลลิลิตร รวมเป็น 80 มิลลิลิตรลงในบีกเกอร์ แล้วนำกระดาษฟอยมาปิดบีกเกอร์ไว้
2. นำบีกเกอร์จากข้อ 1. ไปแช่ให้เย็นจัดในน้ำแข็งประมาณ 30 นาที



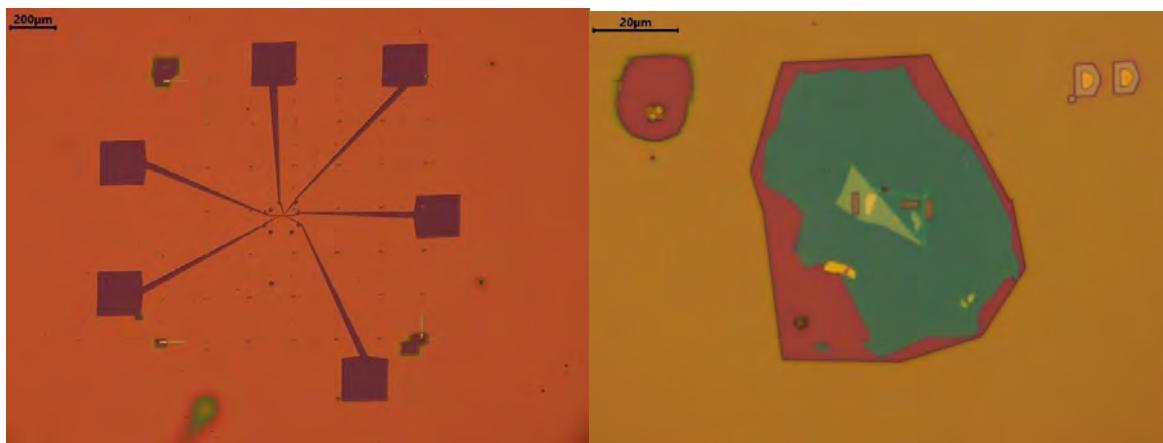
รูปที่ 28 ขั้นตอนการเตรียม developer

3. เมื่อครบเวลาเปิดกระดาษโฟร์ออกโดยที่บีกเกอร์ยังคงแข็งอยู่ในน้ำแข็ง จานั้นนำ tweezer คิบชิลิกอน ที่มีชิ้นงานลงไปแข่นและเบ่าๆ อย่าให้แผ่นชิลิกอนหลุดออกจาก tweezer ประมาณ 1 นาที (พยายามรักษาเวลาให้พอดี ถ้าหากงานเกินไปอาจทำให้ PMMA ส่วนอื่นที่เราต้องการให้หลุดออกมากด้วย)



รูปที่ 29 วิธีการเบ่า tweezer ในบีกเกอร์ที่มี developer

4. นำไปแช่ใน IPA อีกบีกเกอร์ 1 นาที (ระหว่างการเปลี่ยนบีกเกอร์อย่าปล่อยให้แผ่นชิลิกอนแห้งและพยายามอย่าให้ชิลิกอนหลุดออกจาก tweezer เพราะจะคิบชิ้นมากยาก
5. ครบ 1 นาทีนำมาเป่าด้วยปืนลมในโตรเจนจนแห้ง



รูปที่ 30 บริเวณของคอนแทค (ซ้าย) และของ etch mask (ขวา) หลังจากการ Develop

Etching with plasma

หลังจากการ Develop ของ etch mask เราจะใช้พลาสม่าโดยใช้แก๊ส CHF_3 ผสมกับ O_2 โดยขั้นแรกคือ เราต้องหาอัตราการสลายตัวที่ความหนาต่างๆ ของ PMMA ได้ชัลไฟร์ เพื่อที่จะกำหนดส่วนที่ไม่ต้องการได้หมดและไม่ส่งผลต่อบริเวณที่ต้องการ

โดยจากการทดลองเจื่อนไขความดันที่ใช้สำหรับขั้นงานครั้งนี้

Pressure	$\text{O}_2(\text{gas})$: 150 mtorr
	$\text{O}_2+\text{CHF}_3(\text{gas})$: 300 mtorr
	$\text{O}_2+\text{CHF}_3(\text{plasma})$: 333 mtorr

เวลาที่ใช้ทั้งหมด 17 นาที



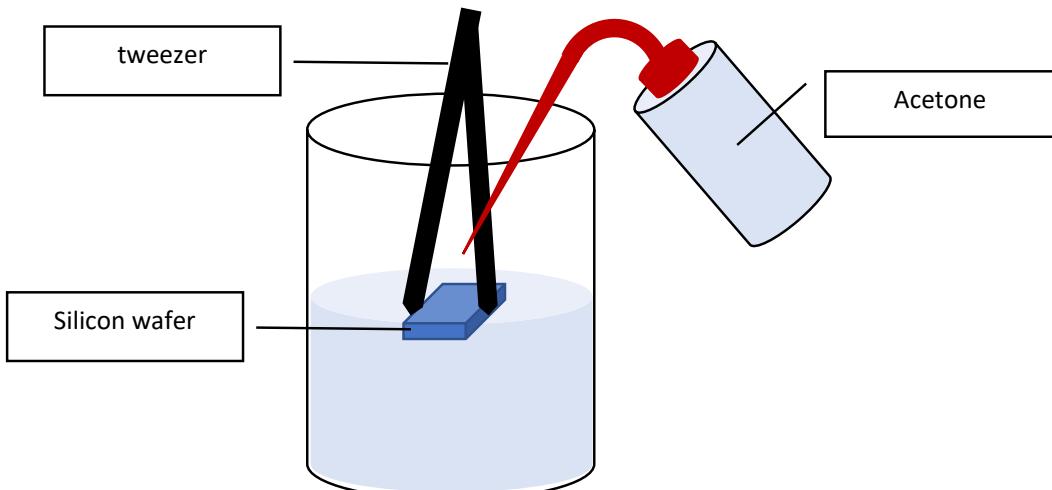
รูปที่ 31 แสดงก่อน (ซ้าย) และหลัง (ขวา) การทำ Plasma etching

Lift-off

หลังจากการ Maker Deposition and sputtering Mo คือใส่ Mo ไปแทนที่ส่วนที่ได้ใน Develop ออก เราต้องทำการเอา PMMA และ Mo ส่วนเกินออกทั้งหมด โดยมีวิธีการดังนี้

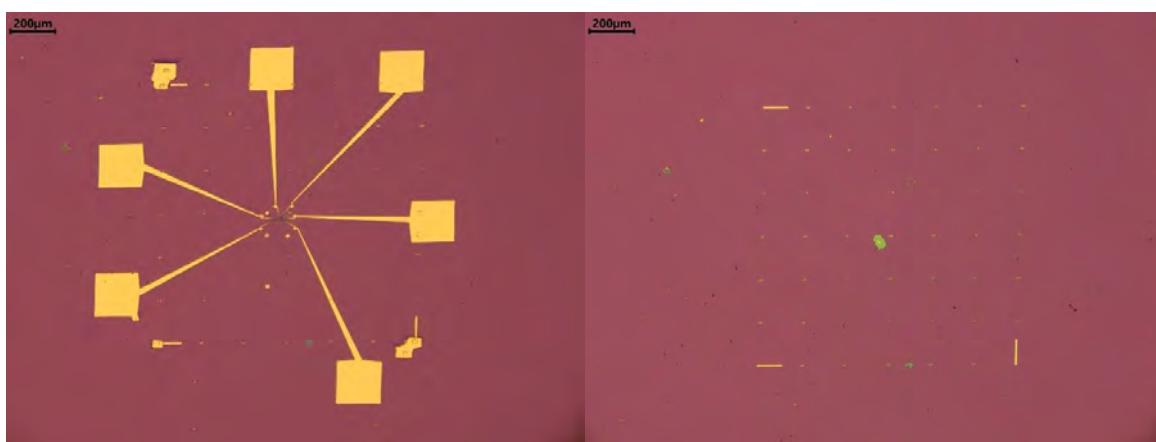
1. นำแผ่นซิลิกอนจากการ sputtering Mo ไปเชื่อมในอะซิโตนขามคืน หรืออย่างน้อย 6 ชั่วโมง (ปิดบีกเกอร์ ด้วยกระดาษฟรอยป้องกันการระเหยของอะซิโตน)
2. นำซิลิกอนจากบีกเกอร์ในข้อ 1. ไปเชื่อมในอะซิโตนที่อยู่อีกบีกเกอร์หนึ่ง

3. คีบแผ่นซิลิกอนขึ้นมาด้วย tweezer และยกขึ้นมาใกล้ผิวน้ำแต่อย่าให้ผิวน้ำของแผ่นซิลิกอนแห้งโดยเด็ดขาด จากนั้นฉีดอะซิโตนไปที่ผิวน้ำแผ่นซิลิกอนเพื่อชงล้าง Mo ออกจนหมด



รูปที่ 32 แสดงวิธีการฉีดอะซิโตนที่ผิวน้ำของแผ่นซิลิกอนที่บริเวณผิวน้ำ

4. นำแผ่นซิลิกอนไปแช่ในบีกเกอร์ IPA
5. นำบีกเกอร์จากข้อ 4. ไปส่องกล้องเพื่อดูผิวของซิลิกอนว่า Mo ที่ไม่ต้องการออกหมดหรือไม่ด้วยกล้องจุลทรรศน์เชิงแสงแบบคร่าวๆ โดยยังคงแข็งซิลิกอนใน IPA ตลอดเวลา เนื่องจากหากผิวน้ำของซิลิกอนแห้งจะไม่สามารถล้างสิ่งต่างๆ ที่อยู่บนซิลิกอนได้อีก เพราะจะติดกับซิลิกอนแน่นขึ้น ถ้า Mo ออกไม่หมดให้ทำตามข้อ 3.-5. อีกรอบ
6. เมื่อออกหมดแล้วให้นำออกจาก IPA และรีบเป่าด้วยปืนลมในโตรเจน



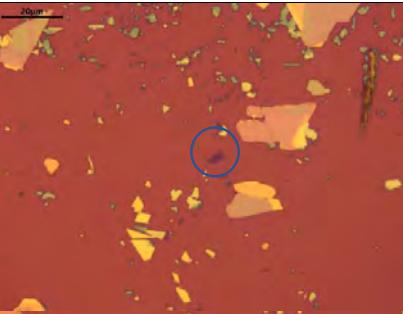
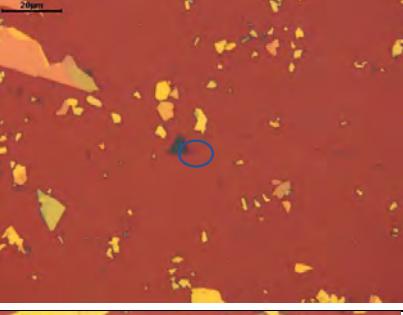
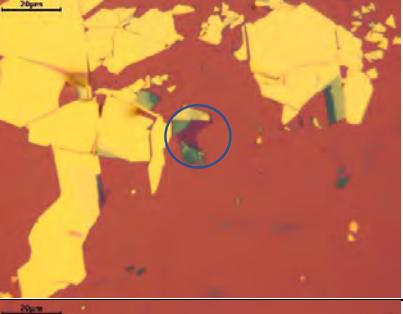
รูปที่ 33 บริเวณที่ถูกแทนที่หลังจาก sputtering Mo และนำมา Lift-off ของคอนแทค (ซ้าย) และ Marker field (ขวา)

บทที่ 4

ผลการทดลอง

4.1 การหา ชิ้น MoS₂

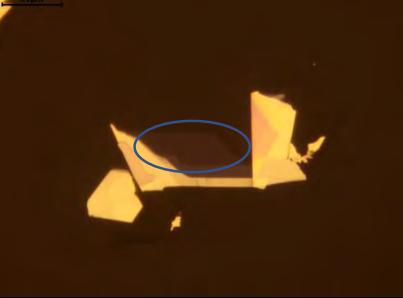
จากการทดลองลอก (exfoliate) MoS₂ ลงบนแผ่นซิลิโคนผลปรากฏว่าได้ชิ้น MoS₂ ดังในตารางดังนี้

ชื่อ	อธิบาย	รูปภาพ
MoS ₂ (si04) _02_100x	<ul style="list-style-type: none"> -a few layer -ขนาดประมาณ $2 \times 4 \mu\text{m}^2$ -ไม่เหมาะสมสำหรับทำ twisted bilayer 	
MoS ₂ (si04) _04_100x	<ul style="list-style-type: none"> -single layer (ใช้วิธี contrast เทียบกับชิ้นที่ทำรามาน) -ขนาดประมาณ $2 \times 2 \mu\text{m}^2$ -ไม่เหมาะสมสำหรับทำ twisted bilayer 	
MoS ₂ (si05) _03_100x	<ul style="list-style-type: none"> -a few layer -ขนาดประมาณ $5 \times 10 \mu\text{m}^2$ -ไม่เหมาะสมสำหรับทำ twisted bilayer 	
MoS ₂ (si05) _05_100x	<ul style="list-style-type: none"> -single layer (ใช้รามานทดสอบ) -ขนาดประมาณ $2 \times 10 \mu\text{m}^2$ -ไม่เหมาะสมสำหรับทำ twisted bilayer 	

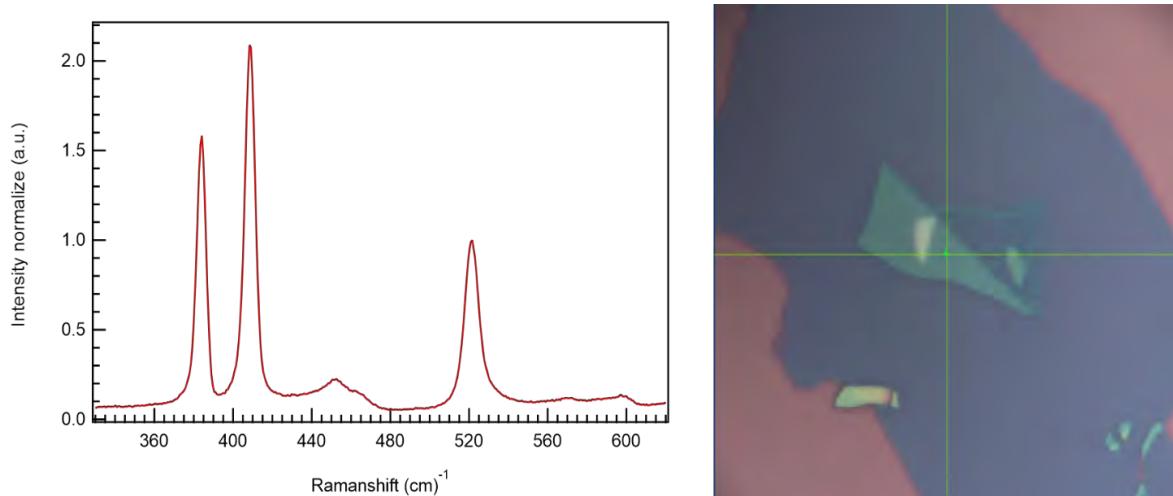
ปัญหาจากการ exfoliate ลงบนแผ่นซิลิกอนคือชิ้น MoS₂ ที่ได้มีหลายชั้นและ single layer ที่ได้มีขนาดเล็กมากไม่เหมาะสมแก่การทำ twisted bilayer ดังนั้นจึงต้องหาวิธีการลอก MoS₂ ใหม่ ให้ได้ single layer ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น วิธีการแก้ปัญหานี้คือเปลี่ยน substrate จากการ exfoliate ลงบนแผ่นซิลิกอน ไปเป็น exfoliate ลงบนแผ่น PDMS แทนซึ่งได้เป็น single layer ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ดังตาราง

ชื่อ	อธิบาย	รูปภาพ
MoS ₂ (PDMS01) _04_100x	-single layer (ใช้รามาน陀สوب) -ขนาดประมาณ 10x15 μm^2 -ไม่เหมาะสมสำหรับทำ twisted bilayer แต่อาจทำ Heterostructure ได้	
MoS ₂ (PDMS01) _05_100x	-single layer (ใช้วิธี contrast เทียบกับชิ้นที่ทำรามาน) -ขนาดประมาณ 5x5 μm^2 -ไม่เหมาะสมสำหรับทำ twisted bilayer	
MoS ₂ (PDMS05) _08_100x	-อาจจะ single layer (ใช้วิธี contrast เทียบกับชิ้นที่ทำรามาน) -ขนาดประมาณ 10x10 μm^2 -ไม่เหมาะสมสำหรับทำ twisted bilayer แต่อาจทำ Heterostructure ได้	
MoS ₂ (PDMS05) _03_100x	-อาจจะ single layer (ใช้วิธี contrast เทียบกับชิ้นที่ทำรามาน) -ขนาดประมาณ 20x60 μm^2 -อาจจะทำ twisted bilayer ได้	

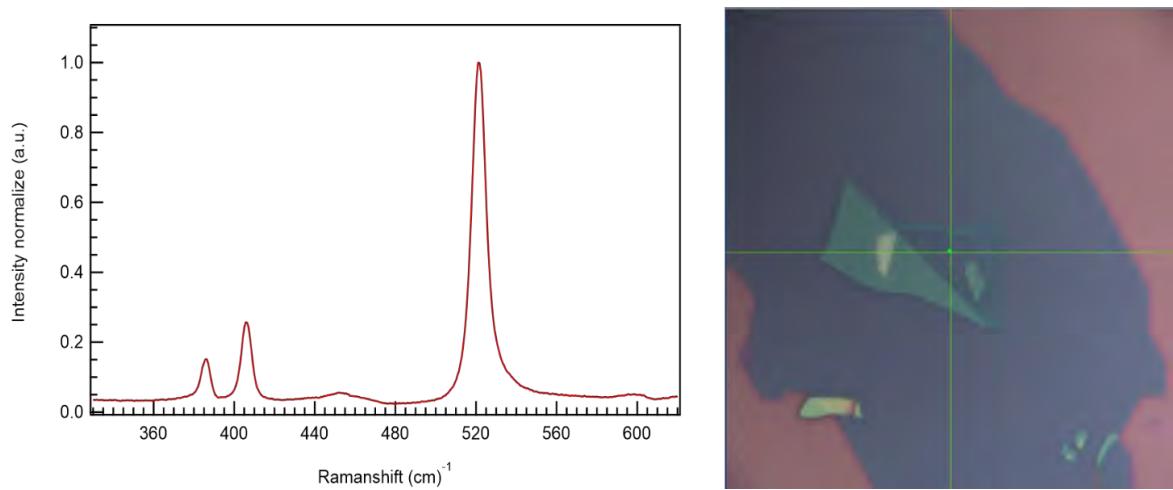
ปัญหาจากการ exfoliate ลงบน PDMS คือเมื่อใช้ PDMS mold ที่ทำไว้เป็นเวลานาน ประสิทธิภาพใน การลอกจะลดลงน่าจะเป็นผลมาจากการเหนียวของ PDMS ลงลดเมื่อตั้งไว้นานๆ ดังนั้นจึงทำการทำ PDMS mold ขึ้นใหม่ ผลคือสามารถลอกได้ single layer ที่มีขนาดใหญ่พอได้มากขึ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ชื่อ	อธิบาย	รูปภาพ
MoS2(PDMS10) _05_100x	-single layer (ใช้วิธี contrast เทียบกับชิ้นที่ทำร้าน) -ขนาดประมาณ $15 \times 30 \mu\text{m}^2$ -สามารถ twisted bilayer และ Heterostructure ได้	
MoS2(PDMS01) _06_100x	-single layer (ใช้วิธี contrast เทียบกับชิ้นที่ทำร้าน) -ขนาดประมาณ $15 \times 15 \mu\text{m}^2$ -สามารถ twisted bilayer และ Heterostructure ได้	
MoS2(PDMS05) _08_100x	-อาจจะ single layer (ใช้วิธี contrast เทียบกับชิ้นที่ทำร้าน) -ขนาดประมาณ $5 \times 50 \mu\text{m}^2$ -อาจจะ twisted bilayer และ Heterostructure ได้	
MoS2(PDMS13) _01_100x	-อาจจะ single layer (ใช้วิธี contrast เทียบกับชิ้นที่ทำร้าน) -ขนาดประมาณ $15 \times 15 \mu\text{m}^2$ -สามารถ twisted bilayer และ Heterostructure ได้	

จากรูปตัวอย่างของรูปโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ชั้งตัน เรายสามารถทราบจำนวนชั้นของโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ได้จากการเทียบสีและดู contrast ของรูปจากกล้องจุลทรรศน์ซึ่งแสดงเทียบกับรูปที่ได้นำตัวอย่างโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ไปวัดค่าスペกตรัมรรمانจนทราบจำนวนชั้นที่แน่นอนแล้ว ซึ่งกราฟรรمانที่ได้มีดังนี้

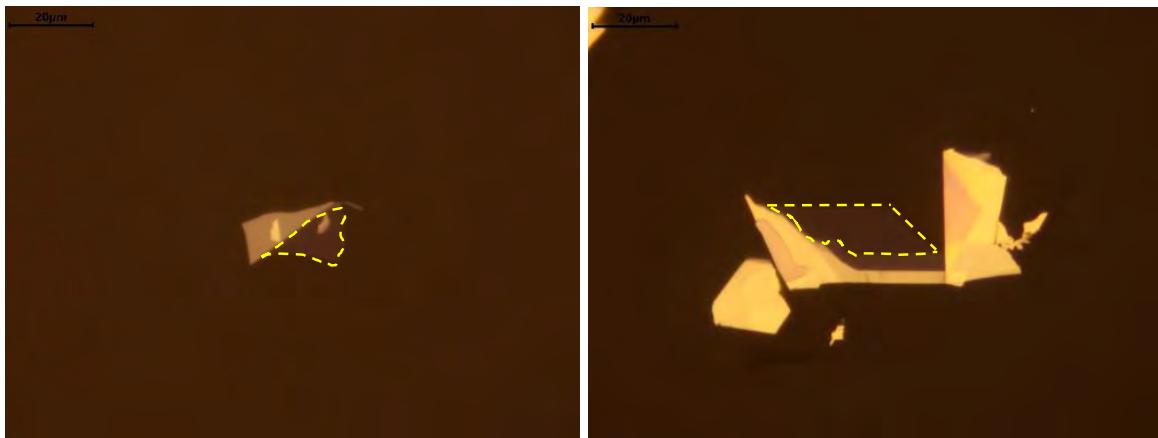


รูปที่ 34 แสดงรรمانสเปกตรัมของโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์จากการลอก (exfoliation) ลงบน PDMS ที่มีพีค E_{2g}^1 และ A_{1g} อยู่ที่ประมาณ 384 cm^{-1} และ 409 cm^{-1} ระยะห่างระหว่างสองพีคเป็น 25 cm^{-1} แสดงให้เห็นว่าเป็นโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์แบบหลายชั้น (multilayer) (ซ้าย) และรูปบริเวณที่ทำการวัดค่าสเปกตรัมรรمانซึ่งคือตรงที่เป็นจุดสีเขียว (ขวา)



รูปที่ 35 แสดงรรманสเปกตรัมของโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์จากการลอก (exfoliation) ลงบน PDMS ที่มีพีค E_{2g}^1 และ A_{1g} อยู่ที่ประมาณ 385 cm^{-1} และ 405 cm^{-1} ระยะห่างระหว่างสองพีคเป็น 20 cm^{-1} แสดงให้เห็นว่าเป็นโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์แบบชั้นเดียว (single layer) (ซ้าย) และรูปบริเวณที่ทำการวัดค่าสเปกตรัมรรمانซึ่งคือตรงที่เป็นจุดสีเขียว (ขวา)

จากรูปเป็นบริเวณที่วัดค่าสเปกตรัมรามานเทียบกับเอกสารอ้างอิงในบทที่สอง ปรากฏว่าเป็นโมลิบดีนัมได้ชัลไฟฟ์ชั้นเดียว (single layer) เมื่อนำไปเปรียบเทียบ contrast กับรูปที่ได้จากการกล้องจุลทรรศน์เชิงแสงของชั้นโมลิบดีนัมได้ชัลไฟฟ์ชั้นอื่นที่มี contrast เหมือนกันแสดงว่าเป็นโมลิบดีนัมได้ชัลไฟฟ์ชั้นเดียวเหมือนกันด้วยตัวอย่างเช่น



รูปที่ 36 แสดงรูปของชั้นโมลิบดีนัมได้ชัลไฟฟ์ชั้นเดียวที่ได้ทำการวัดค่าสเปกตรัมรามาน (ซ้าย) กับชั้นของโมลิบดีนัมที่นำมาเทียบ contrast พบร่วมกับชั้นเดียวเหมือนกัน สามารถนำหลักการนี้มาใช้ในการหาชั้นโมลิบดีนัมที่เหมาะสมในการนำมาใช้งานต่อไป

โมลิบดีนัมได้ชัลไฟฟ์จากการ CVD

เนื่องจากโมลิบดีนัมได้ชัลไฟฟ์จากการ CVD นี้ถูกสร้างขึ้นในห้องวิจัยและทดลองอื่นที่สร้างอุกมาเป็นโมลิบดีนัมได้ชัลไฟฟ์แบบชั้นเดียวเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเราจึงนำค่าสเปกตรัมรามานและนำไปสร้างเป็นชิ้นงานที่ต้องการได้เลย

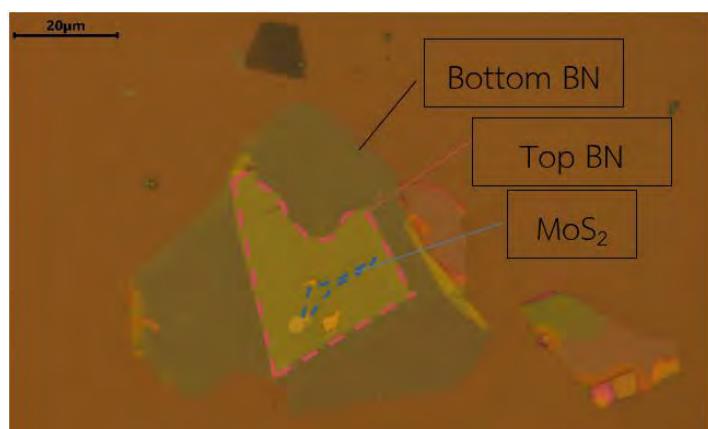


รูปที่ 37 ตัวอย่างโมลิบดีนัมได้ชัลไฟฟ์ที่ถ่ายจากการกล้องจุลทรรศน์เชิงแสงที่ได้จากการ CVD

4.2 วิธีการถ่ายโอนแบบแห้ง (dry transfer method)

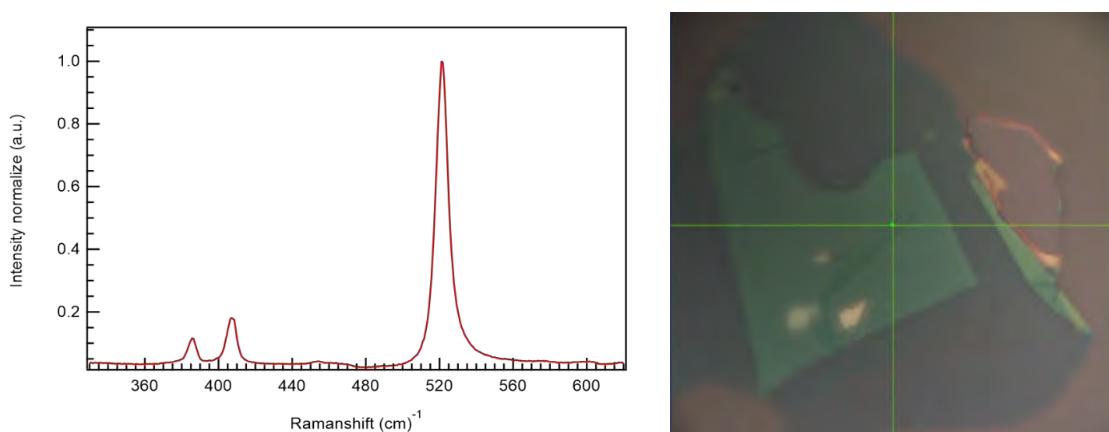
4.2.1 วิธีการเคลื่อนย้ายด้วยแรงแวนเดอร์วาลส์ (van der Waals pick-up transfer Method)

เนื่องจากชั้น MoS₂ ที่ได้จากการ exfoliate บนแผ่นซิลิกอนมีขนาดเล็กเกินไปไม่สามารถสร้างเป็น twisted bilayer ได้ จึงได้ลอง BN pick-up โดยใช้ PC polymer stack เป็นชั้นแบบ BN/MoS₂/BN เพื่อคุ้มครองชั้น MoS₂ ออกมากจากพื้นผิวที่เป็นซิลิกอนผลปรากฏว่าสามารถดึงชั้นมาได้ แต่ยังไม่ได้ลองชิ้น MoS₂ เนื่องจากขนาดที่เล็กเกินไป อย่างไรก็ตามวิธีการ exfoliate บนแผ่นซิลิกอนก็ยังไม่ใช้วิธีที่ดีเท่าที่ควรเนื่องจากโอกาสในการเจзо MoS₂ แบบชั้นเดียวมีน้อยมากและมีขนาดเล็กมาก



รูปที่ 38 BN/MoS₂/BN Heterostructure

เมื่อนำมาวัดค่ารamanปรากฏว่ามีส่วนที่เป็นแบบหนึ่งชั้น (single layer)

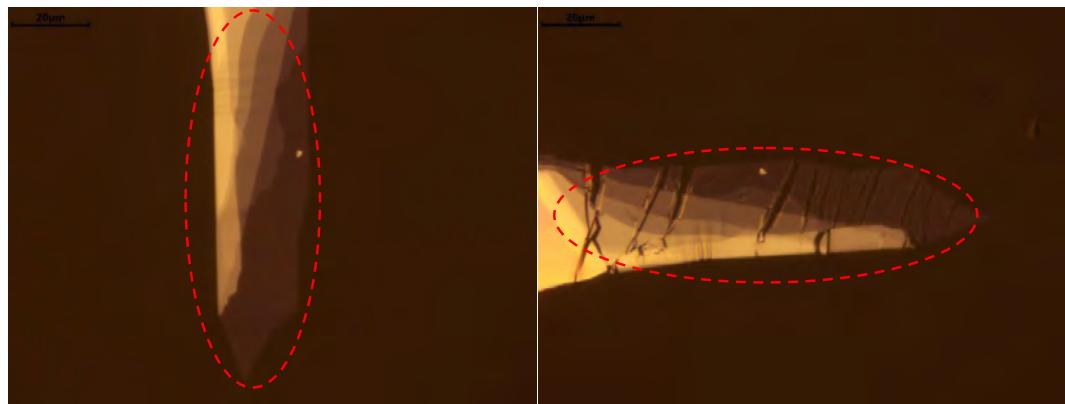


รูปที่ 39 รามานสเปกตรัมของ BN/MoS₂/BN Heterostructure ซึ่งเป็นโมลิบดีนัมไดซัลไฟต์จากการลอก (exfoliation) บนแผ่นซิลิกอนที่มีพีค E_{2g}^1 และ A_{1g} อยู่ที่ประมาณ 387 cm^{-1} และ 407 cm^{-1} ระยะห่างระหว่างสองพีคเป็น 20 cm^{-1} แสดงให้เห็นว่าเป็นโมลิบดีนัมไดซัลไฟต์แบบชั้นเดียว (single layer) (ซ้าย) และรูปบริเวณที่วัดค่าสเปกตรัมรามานซึ่งคือตรงที่เป็นจุดสีเขียว (ขวา)

4.2.2 วิธีการเคลื่อนย้ายด้วย PDMS

ชิ้น MoS₂ ที่ได้จากการ exfoliate บน PDMS มีขนาดใหญ่พอที่จะสามารถสร้างเป็น twisted bilayer ได้ จึงได้ลองนำ PDMS โดยจะตัดแค่ส่วนที่มีชิ้น MoS₂ แล้วนำไปวางลงบนชิลิกอนเปล่าก่อนที่จะใช้วิธีการ Tear and stacking ด้วย BN แต่เกิดปัญหา 2 อย่างคือ

ประการแรก ระหว่างการตัด PDMS ขนาด $0.4 \times 0.4 \text{ cm}^2$ ในบริเวณที่มีชิ้น MoS₂ ผลปรากฏว่าหากตัด แรงไป ใบมีดไม่คม หรือลงใบมีดผิดวิธี อาจจะทำให้ชิ้น MoS₂ เกิดการย่นและฉีกขาดเสียหาย วิธีแก้ไขคืออาจจะ ตัดให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อย แต่ห้ามใหญ่เกินไป ใช้ใบมีดที่คมอยู่เสมอ และลงน้ำหนักให้สม่ำเสมอในการตัด



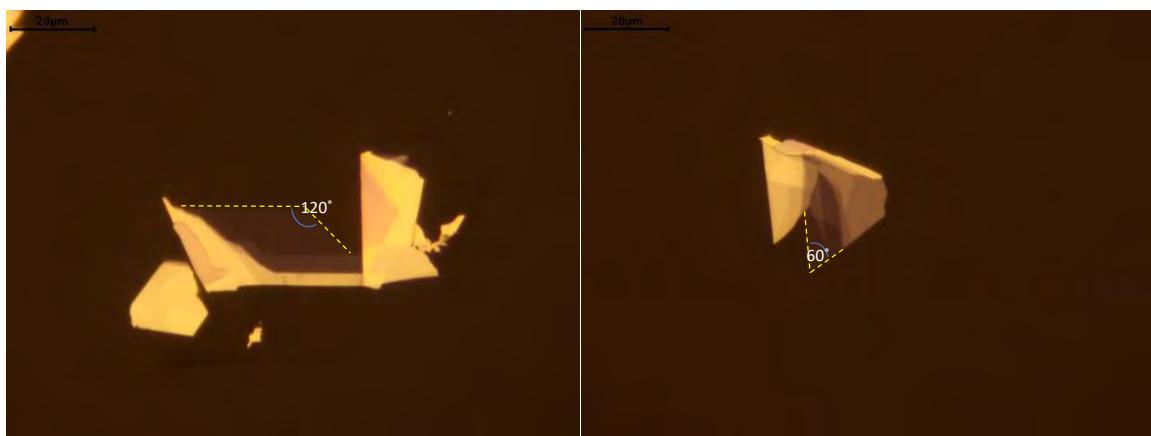
รูปที่ 40 แสดงชิ้น MoS₂ บน PDMS ก่อน (ซ้าย) และหลัง (ขวา) การตัดด้วยใบมีด

ประการที่สอง ระหว่างทำการถ่ายโอนชิ้น MoS₂ บน PDMS ไปยังแผ่นชิลิกอนเปล่าๆ จะมีบางส่วนของชิ้น MoS₂ ยังคงติดอยู่บน PDMS หรือมีการยับ โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นแบบหนึ่งชิ้นจะยึดติด PDMS ได้มาก

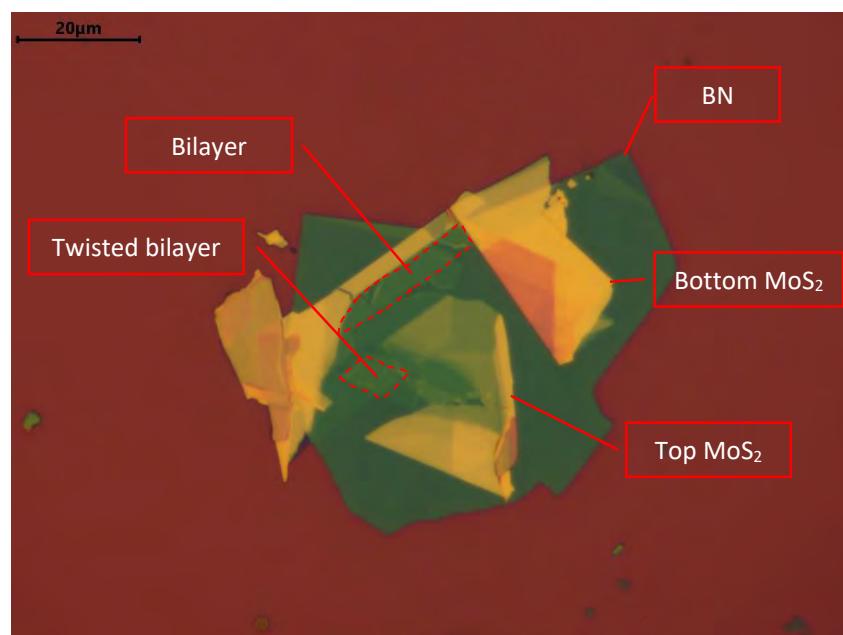


รูปที่ 41 แสดงชิ้น MoS₂ ก่อน (บน PDMS) (ซ้าย) และหลัง(บนแผ่นชิลิกอน) (ขวา) การเคลื่อนย้ายลงบนแผ่นชิลิกอนผลปรากฏว่า มีรอยยับเกิดขึ้นไม่สามารถนำไปใช้ต่อได้

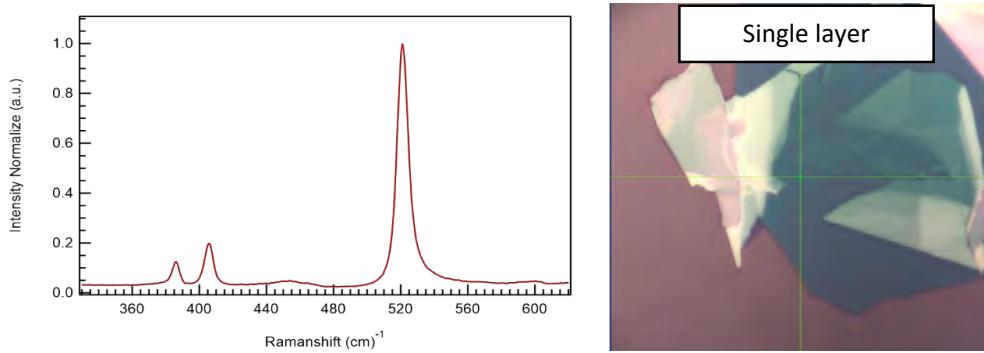
และเมื่อลองนึกและตีงชิ้น MoS₂ ด้วย BN/PC polymer stacking ผลปรากฏว่าไม่สามารถนีกชิ้น MoS₂ ได้เนื่องจาก MoS₂ ยึดติดกับพื้นผิวได้ดีมาก จึงแก้ปัญหาโดยการใช้รูปแบบของชิ้น MoS₂ ที่เราหาเจอ จะสังเกตเห็นว่าขอบจะตรงและมุ่งที่เกิดขึ้นมักจะเป็น 60 องศา หรือ 120 องศาเสมอ จึงเปลี่ยนมาทำ twisted จากการนำชิ้น MoS₂ สองชิ้นมาซ้อนกัน เทียบโดยการวางขอบๆนึงให้ตรงกันก่อนหมุนเป็นมุ่ง 3.5 องศา โดยจะนำไปวางบน BN ทีละชิ้น เนื่องจากชิ้น MoS₂ ยึดติดกับ BN ได้ดีกว่า PDMS และมีความสะอาดกว่าแผ่นซิลิกอน



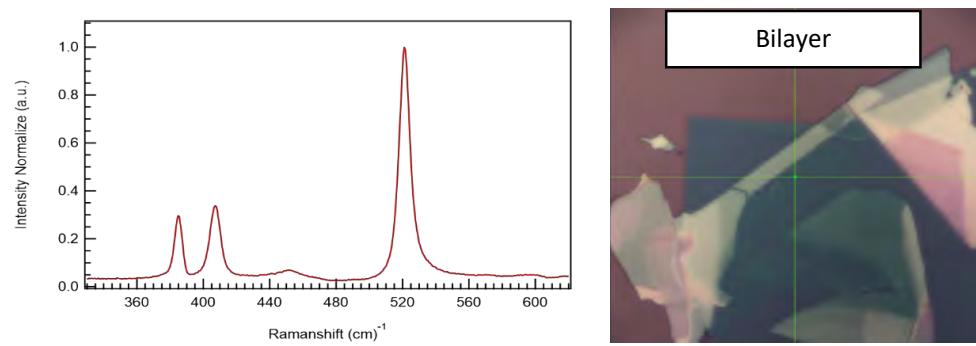
รูปที่ 42 แสดงให้เห็นขอบของโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์บางด้านที่จะเป็นเส้นตรง และมุ่งของโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ที่จะมีบางมุ่งเป็น 60 หรือ 120 องศา



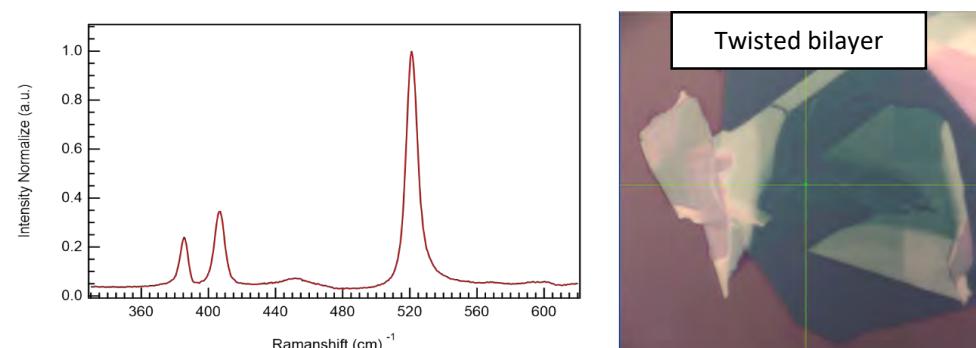
รูปที่ 43 twisted bilayer MoS₂ ที่ได้จากการเคลื่อนย้ายด้วย PDMS ไปวางบน BN



รูปที่ 44 รaman สเปกตรัมโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ชั้นเดียวจากการลอก (exfoliation) บน PDMS ที่มีพีค E_{2g}^1 และ A_{1g} อยู่ที่ประมาณ 385 cm^{-1} และ 405 cm^{-1} ระยะห่างระหว่างสองพีคเป็น 20 cm^{-1} (ช้าย) และรูปบริเวณที่วัดค่าสเปกตรัมรaman ชั้งคือตrong ที่เป็นจุด สีเขียว (ขวา)



รูปที่ 45 รaman สเปกตรัมโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ชั้นเดียวจากการลอก (exfoliation) บน PDMS ที่มีพีค E_{2g}^1 และ A_{1g} อยู่ที่ประมาณ 385 cm^{-1} และ 407 cm^{-1} ระยะห่างระหว่างสองพีคเป็น 22 cm^{-1} (ช้าย) และรูปบริเวณที่วัดค่าสเปกตรัมรaman ชั้งคือตrong ที่เป็นจุด สีเขียว (ขวา)



รูปที่ 46 รaman สเปกตรัมของ tMoS₂/BN ชั้งเป็นโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์จากการลอก (exfoliation) บน PDMS ที่มีพีค E_{2g}^1 และ A_{1g} อยู่ที่ประมาณ 385 cm^{-1} และ 406 cm^{-1} ระยะห่างระหว่างสองพีคเป็น 21 cm^{-1} (ช้าย) และรูปบริเวณที่วัดค่าสเปกตรัมรaman ชั้งคือตrong ที่เป็นจุด สีเขียว (ขวา)

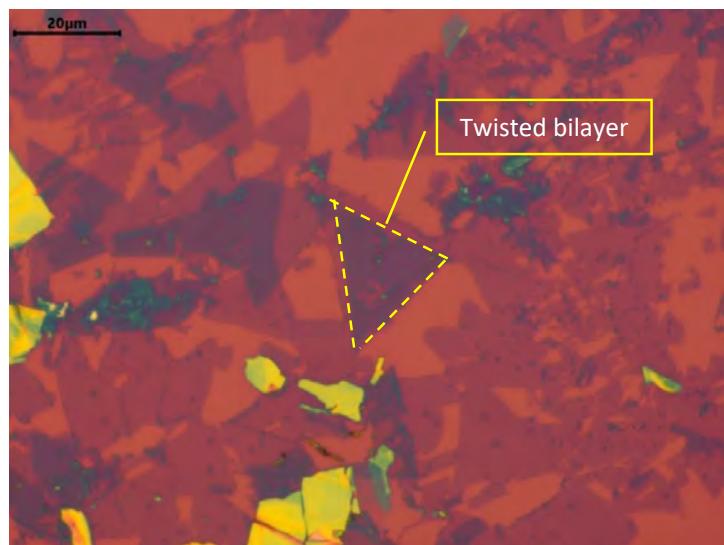
4.3 วิธีการถ่ายโอนแบบเปียก (wet transfer method)

วิธีการนี้จะนำมาใช้ในโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ชั้นเดียวที่ได้จากการสร้างแบบ CVD เนื่องจากก่อนหน้านี้เมื่อลองใช้วิธีการเคลื่อนย้ายด้วยแรงแวงเดอร์วัลส์โดยลง BN pick-up โดยใช้ PC polymer stack แต่เนื่องจากวิธีการ CVD จะทำให้โมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ยืดติดกับชิลิกอนได้มาก ผลที่ได้คือมีโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์บางส่วนเท่านั้นที่ติดขึ้นมา ไม่ได้ติดขึ้นมาทั้งแผ่น จึงไม่สามารถนำไปใช้ในการทำ twisted bilayer ได้

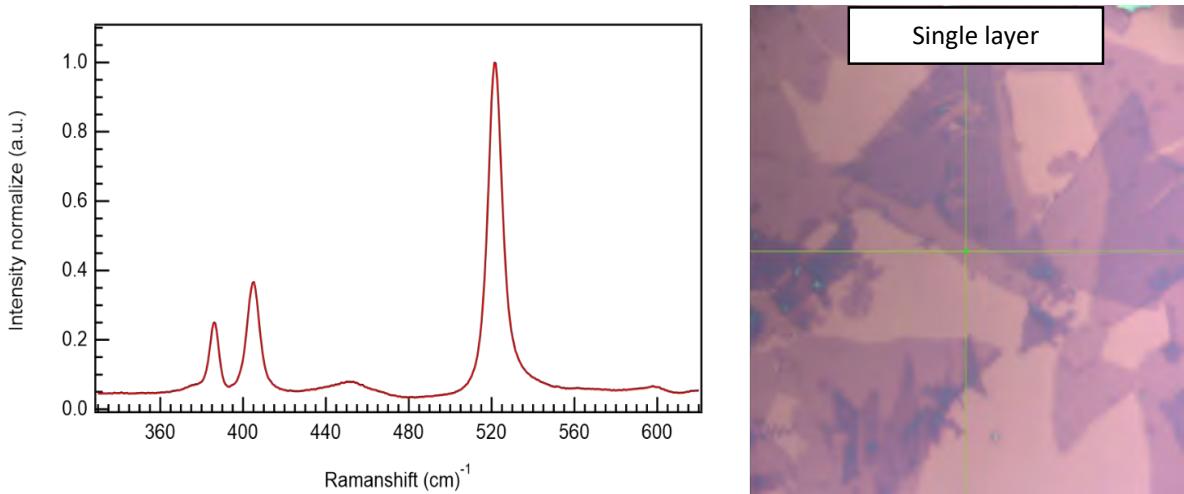


รูปที่ 47 แสดง BN/PC polymer stack ก่อน (ซ้าย) และหลัง (ขวา) การ pick-up ด้วยวิธีการเคลื่อนย้ายด้วยแรงแวงเดอร์วัลส์

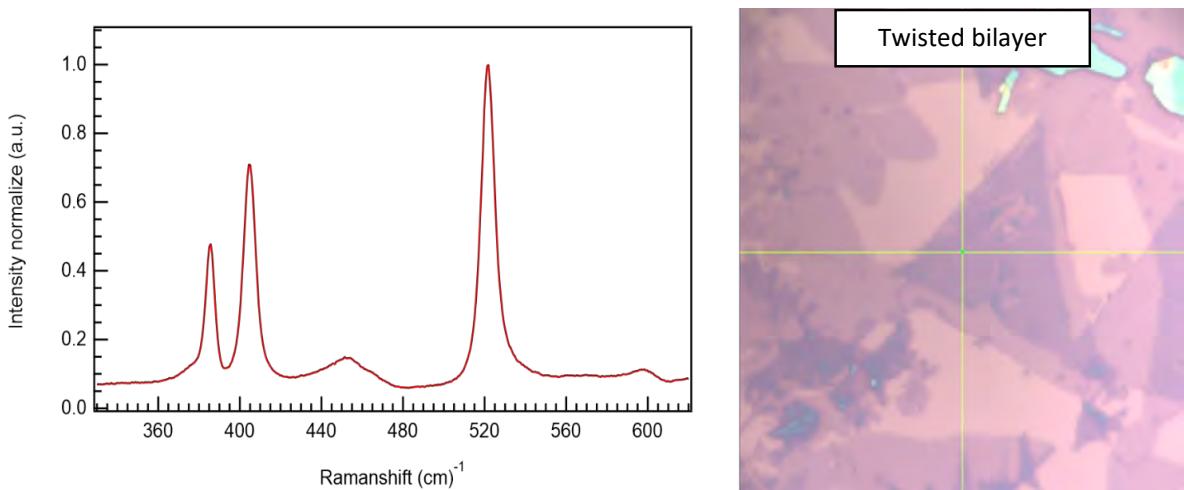
จึงแก้ปัญหาโดยการลดแรงระหว่างโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์กับแผ่นชิลิกอนด้วยการใช้น้ำ หรือวิธีการถ่ายโอนแบบเปียก (wet transfer method) จากนั้นนำไปวางบน BN แต่ไม่สามารถวางลงไปได้เนื่องจากโมลิบดีนัมไม่ติดกับ BN จึงต้องนำไปวางบนแผ่นชิลิกอนเปล่าแทน



รูปที่ 48 twisted bilayer MoS₂ บนแผ่นชิลิกอน

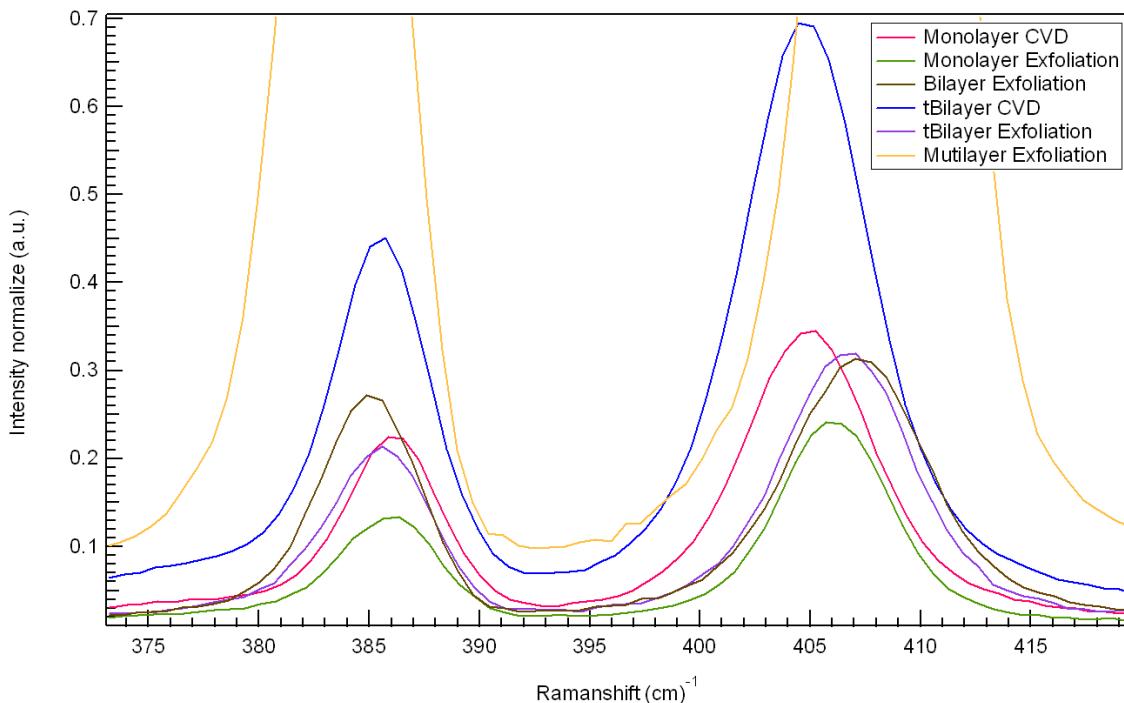


รูปที่ 49 รamanスペกตรัมของโมลิบดีนัมไดซัลไฟเดชั้นเดียวจากการ CVD ที่มีพีค E_{2g}^1 และ A_{1g} อุ่นที่ประมาณ 386 cm^{-1} และ 405 cm^{-1} ระยะห่างระหว่างสองพีคเป็น 19 cm^{-1} (ช้าย) และรูปบริเวณที่วัดค่าスペกตรัมร้านานซึ่งคือตรงที่เป็นจุดสีเขียว (ขวา)



รูปที่ 50 รamanスペกตรัมของโมลิบดีนัมไดซัลไฟเดชัลแบบ twisted bilayer จากการ CVD ที่มีพีค E_{2g}^1 และ A_{1g} อุ่นที่ประมาณ 386 cm^{-1} และ 404 cm^{-1} ระยะห่างระหว่างสองพีคเป็น 18 cm^{-1} (ช้าย) และรูปบริเวณที่วัดค่าスペกตรัมร้านานซึ่งคือตรงที่เป็นจุดสีเขียว (ขวา)

จากนั้นนำค่าスペกตรัมของโมลิบดีนัมไดซัลไฟเดชัลที่วัดค่าได้ทั้งที่เป็นชั้นเดียว (single layer) ที่เป็นสองชั้น (Bilayer) และที่นำมาวางช้อนกันเป็นสองชั้นที่มุ่งบิด 3.5 องศา ของทั้งที่ได้จากการลอก (exfoliation) และวิธีการ CVD มา normalize เทียบกับพีคของชิลิกอน จากนั้นนำมาวิเคราะห์แนวโน้มจากการลอก ลักษณะการเลื่อนช้ายาวและความเข้มของพีคว่าเป็นผลมาจากการลอก ผลที่ได้มีดังต่อไปนี้

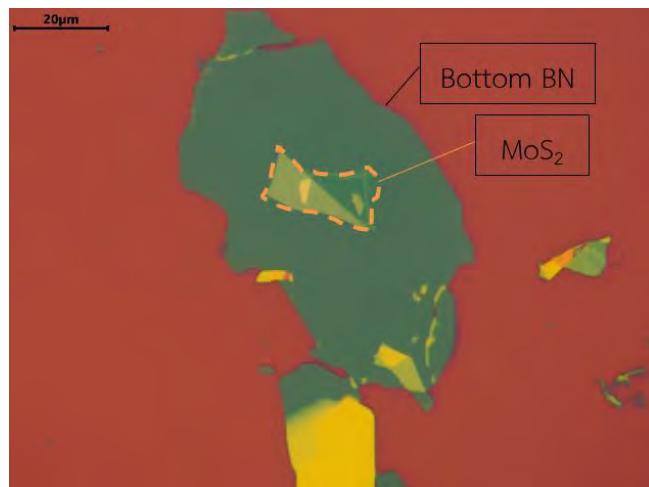


รูปที่ 51 รamananスペクト럼ของโมลิบเดียมไดซัลไฟด์เป็นชั้นเดียว (single layer) ที่เป็นสองชั้น (Bilayer) และที่นำมารังซ่อนกันเป็นสองชั้นที่มุ่งเปิด 3.5 องศา ของทั้งที่ได้จากการลอก (exfoliation) และวิธีการ CVD

จากการวิเคราะห์พบว่าจะเห็นว่าพีคของ twisted bilayer MoS₂ ที่ได้จากการลอก (exfoliation) จะมีค่าอยู่ระหว่างพีคของ single layer และ Bilayer โมลิบเดียมไดซัลไฟด์ แต่ว่าด้วยความเข้มไดมากกว่าที่เป็น Bilayer ปกติ ในขณะที่พีคของtwisted bilayer MoS₂ ที่ได้จากการ CVD จะมีพีคใกล้เคียงกับที่เป็น single layer

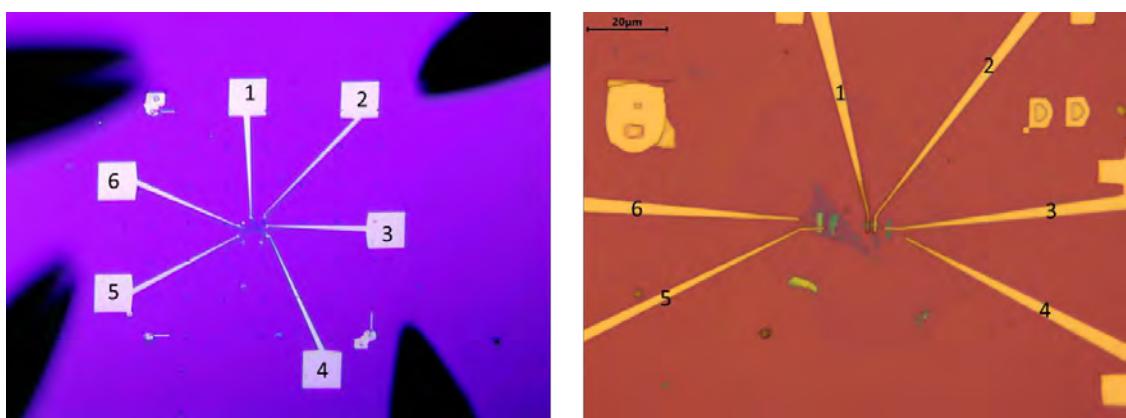
4.4 การวัดค่าทางไฟฟ้า (Electrical measurement)

เราจะทำการสร้างวัสดุเชิงแวนเดอร์วัลส์ที่ประกอบจากโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ที่วางอยู่บนเอกซ์กอกอนอล บอรอนไนโตรด์ โดยใช้ MoS_2 ที่ได้จากการ exfoliate บน PDMS และ transfer ลงบน BN ที่อยู่บนแผ่นซิลิกอน จากนั้นนำมา etch ให้เหลือแค่บริเวณที่ต้องการวัดและใส่ค่อนแทคเพื่อวัดค่าทางไฟฟ้า



รูปที่ 52 MoS_2/BN Heterostructure ก่อนที่จะทำการ etch และใส่ค่อนแทค

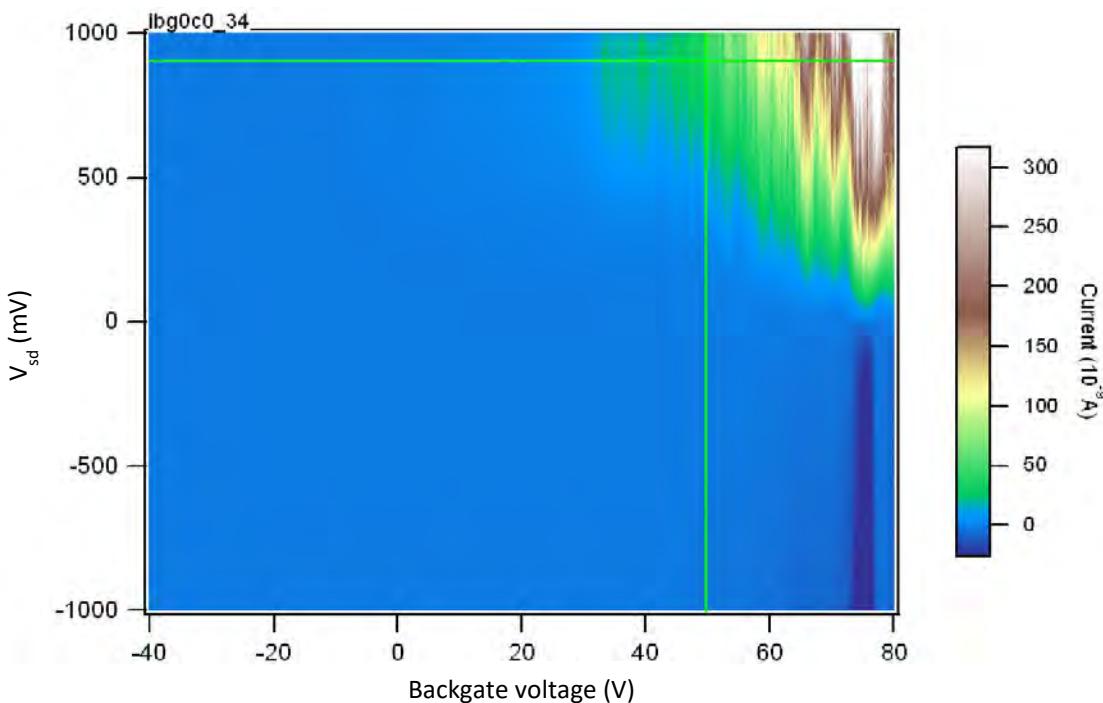
ปัญหาของการใส่ค่อนแทค ประการแรกอยู่ที่ขั้นตอน EBL ที่ต้องใช้ความเข้มของลำอิเล็กตรอนให้เหมาะสมกับโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ ถ้าใช้ความเข้มที่ไม่เหมาะสมจะเกิดปัญหาต่อในขั้นตอนการ develop ที่จะทำให้ PMMA ส่วนที่เรายังต้องการหลุดออกมากด้วย และประการที่สองอยู่ที่ขั้นตอนการ etch ด้วยพลาสม่าที่เราต้องแนใจว่าโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ส่วนที่ไม่ต้องการนั้นถูกกำจัดไปหมดแล้ว ตรวจสอบโดยการนำไปวัดค่ารามาน บริเวณที่ไม่ต้องการจะต้องไม่มีพิคของสเปกตรัมโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์เกิดขึ้นมา



รูปที่ 53 แสดง Prob ที่ใช้วัดค่าทางไฟฟ้า (ซ้าย) และแสดงขั้นงานหลังจากการใส่ค่อนแทคเสร็จเรียบร้อย (ขวา)

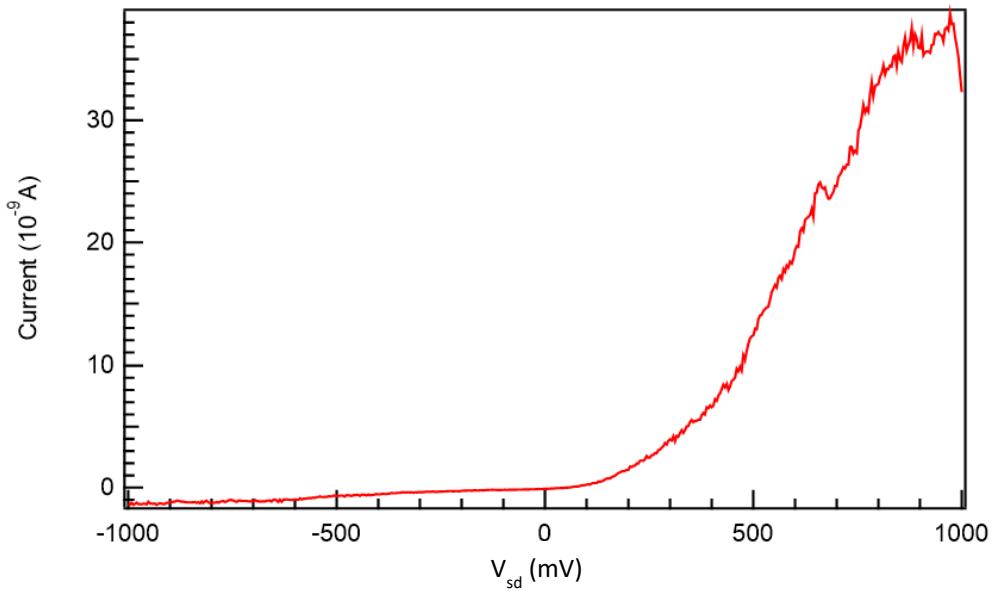
ปัญหาของการใส่ค่อนแทค ประการที่สามอยู่ที่หลังจากการใส่ค่อนแทคเสร็จเรียบร้อย จากรูป 53 ถ้าสังเกตจะเห็นว่าจากเกตหมายเลข 4 และ 6 ที่ระบุบนรูป มี Mo ไม่ติดกับโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกว่า Mo ยึดติดกับโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ได้ไม่ดีและอาจจะดูเหมือนมี Mo บางเกตติดกับโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ได้แต่เมื่อสังเกตผ่านกล้อง optical microscope มันจะดูเหมือน Mo ลอยขึ้นมาจากโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์

เมื่อทำการวัดค่าทางไฟฟ้าโดยจะวัดค่าของกระแส I_{sd} ที่ความต่างศักย์ V_{sd} ต่างๆ โดยเปลี่ยนความต่างศักย์ V_{bg} ครั้งละ 0.05 โวลต์ ตั้งแต่ -40 ถึง 80 โวลต์ ได้กราฟดังนี้

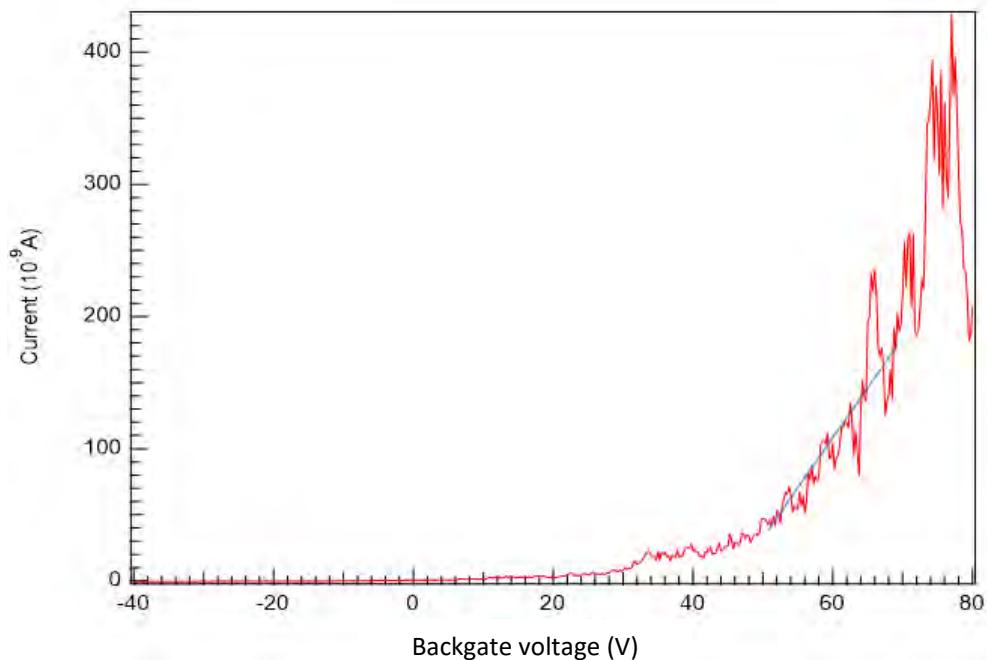


รูปที่ 54 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างของกระแส I_{sd} , V_{sd} และ V_{bg} ของโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์

จากนั้นได้ทำการเลือกมาหนึ่งจุดเพื่อหาค่า mobility ของโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์แบบขั้นเดียวนี้ โดยจุดที่เลือกจะเป็นจุดที่กราฟมีชุดข้อมูลการวัดที่ไม่แปรปรวนมาก เนื่องจากเราจำเป็นต้อง fitting กราฟเพื่อหาความชันก่อนที่จะนำไปคำนวณค่า mobility โดยจุดที่เลือกนำมาคำนวณคือ ที่ V_{sd} เท่ากับ 900 นาโนโวลต์ และ V_{bg} เท่ากับ 50 โวลต์ ดังกราฟต่อไปนี้



รูปที่ 55 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง I_{sd} กับ V_{sd} ที่อุณหภูมิห้อง โดยใส่ V_{bg} เป็น 50 โวลต์



รูปที่ 56 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง I_{sd} กับ V_{bg} ที่อุณหภูมิห้อง โดยใส่ V_{sd} เป็น 900 นาโนโวลต์

จากรูปที่ 56 สามารถนำมา fitting ความชันของกราฟในช่วงที่มีค่า V_{bg} ตั้งแต่ 45 ถึง 65 โวลต์ (เนื่องจากกราฟที่ได้นั้นมีความแปรปรวนจึงไม่สามารถใช้ differentiate ในการหาได้ จึงต้องเลือกค่ามาแค่ช่วงที่มีความแปรปรวนน้อย มาคำนวณหาความชันแทน) ซึ่งค่าความชันที่ได้ประมาณ $8.67 \times 10^{-9} \text{ A/V}$

และการหาค่า gate capacitance per unit area ของ two parallel plate ของแผ่นซิลิกอนที่มีความหนา 285 นาโนเมตร มีค่าคงที่ dielectric เท่ากับ 3.7 จากสมการ

$$C_g = \frac{KE_0}{D}$$

โดยที่

C_g คือ gate capacitance per unit area (F/m^2)

E_0 คือ permittivity of free space มีค่าเท่ากับ $8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$

K คือ dielectric constant ของแต่ละวัสดุ ซึ่งของแผ่นซิลิกอนมีค่าเท่ากับ 3.7

D คือ ระยะทางระหว่าง plate (m^2)

ได้ค่า gate capacitance per unit area เท่ากับ $1.15 \times 10^{-4} \text{ F/m}^2$

จากนั้นนำค่าความชันและค่า gate capacitance per unit area ไปหาค่า mobility ในทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าของคอนแทคขนาด $1.6 \times 4.3 \mu\text{m}^2$ ที่ให้ความต่างศักย์ระหว่าง source และ drain เท่ากับ 900 mV จากสมการ

$$\mu = slope \times \frac{L}{W} \times \frac{1}{V_{sd}} \times \frac{1}{C_g}$$

โดยที่

μ คือ ค่า mobility ($\text{m}^2/\text{V.s}$)

L คือ ความยาวของคอนแทค (μm)

W คือ ความกว้างของคอนแทค (μm)

V_{sd} คือ source drain bias (V)

จะได้ค่า mobility เท่ากับ $2.25 \text{ cm}^2/\text{V.s}$ ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับค่าที่ได้ทำการศึกษาในบทที่ 2 เนื่องมาจาก mobility จะขึ้นอยู่กับค่า conductivity ของระบบด้วยว่าตีหรือไม่ นั่นแสดงว่าการที่คอนแทค Mo ยึดติดกับโมลิบเดียมได้ชั้นไฟฟ์ได้ไม่ดีจะทำให้ค่า conductivity ลดลงไปเยอะกว่าปกติ ส่งผลให้ค่า mobility ที่ได้นั้นน้อยตามไปด้วย

บทที่ 5

สรุปและอภิปรายผลการทดลอง

การสร้างและการศึกษาคุณลักษณะของวัสดุเชิงแวนเดอร์วัลส์ที่ประกอบจากโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ในครั้งนี้มีปัญหาเกิดขึ้นในหลายขั้นตอนที่จำเป็นต้องแก้ปัญหาไปทีละขั้น

เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์เป็นชั้นเดียว (single layer) โดยการลอก (exfoliation) ขึ้นมาให้มีขนาดที่สามารถนำไปใช้งานได้ ซึ่งต้องแก้ปัญหาโดยการหาแผ่นรองรับที่เหมาะสมที่จะสามารถยึดโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ให้ติดกับพื้นผิวของแผ่นรองรับนั้นได้ นั่นแสดงว่าจะต้องมีเป็นแรงยึดติดระหว่างผิวของแผ่นรองรับกับพื้นผิวของโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ที่มากกว่าแรงแวนเดอร์วัลส์ (Van der Waals) ที่ยึดติดระหว่างชั้นของโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ด้วยกันเอง ซึ่งแผ่นรองรับที่เหมาะสมสมคือ polydimethylsiloxane หรือ PDMS

ปัญหาที่สองคือในขั้นตอนถ่ายโอน (transfer) คือจำเป็นต้องถ่ายโอนโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ชั้นเดียวที่ได้จากการลอกลงบนแผ่น PDMS ลงไปบนแผ่นชิลิกอนสะอาดแต่ไม่เป็นผลสำเร็จ น่าจะเนื่องมาจากโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์สามารถยึดติดกับ PDMS ได้ดีกว่าแผ่นชิลิกอน ดังนั้นเราจึงหาวัสดุที่มีแรงยึดติดระหว่างพื้นผิวได้ดีกว่า PDMS เพื่อที่จะสามารถถ่ายโอนโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ได้ วัสดุนั้นคือ Hexagonal boron nitride หรือ BN ที่ลอกบนแผ่นชิลิกอน ทำให้สามารถถ่ายโอนโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์เพื่อทำเป็น twisted bilayer และทราบซิสเทอร์ในการวัดค่าทางไฟฟ้าต่อไป

อีกปัญหาคือ โมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ชั้นเดียวบนแผ่นชิลิกอนที่ได้จากการเคลือบไอระเหยทางเคมี (Chemical Vapor Deposition หรือ CVD) ที่ไม่สามารถใช้ PC polymer stack ในการถ่ายโอนแบบแห้ง (dry transfer) ได้เนื่องจากโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ที่ได้จากการสร้างด้วยวิธีการนี้มีแรงยึดติดกับแผ่นรองรับที่เป็นชิลิกอนได้ดีมาก จึงพยายามหาวิธีที่ง่ายที่สุดในการลดแรงยึดติดระหว่างผิวของโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์กับแผ่นชิลิกอนให้ลดลง จากการศึกษาพบว่าสามารถลดแรงระหว่างผิวนี้ได้ดังนั้นเราจะใช้วิธีการถ่ายโอนแบบเปียก (wet transfer) ในการถ่ายโอนแทน

เมื่อสามารถสร้างเป็นชิ้นงานตามต้องการได้แล้วเราจะนำชิ้นงานเหล่านี้ไปวัดค่าสเปกตรัมรามานด้วยเครื่อง Raman spectroscopy ทั้งจากการสร้างด้วยการลอกและวิธีการ CVD ไม่ว่าจะเป็นแบบชั้นเดียว (single layer), สองชั้น (bilayer), สองชั้นที่วางซ้อนกันเป็นมุนบิด (twisted bilayer) ที่ยึดติดการด้วยแรงแวนเดอร์วัลส์ และหลายชั้น (multilayer) จากนั้นนำมา normalize และเปรียบเทียบค่าแต่ละพีคทั้ง E_{2g}^1 และ A_{1g} ผลปรากฏว่า พีคของ twisted bilayer ที่ได้จากการลอก (exfoliation) ลงบน PDMS จะมีค่าอยู่ระหว่างพีคของ single layer

และ Bilayer โมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ต์ แต่จะวัดค่าความเข้มได้ด้วยกว่าที่เป็น Bilayer แสดงให้เห็นว่าถึงแม้จะมีสองชั้น เหมือนกันแต่การวางแผนกันของโครงสร้างที่ต่างกันนี้และการปรับเปลี่ยนมุ่ง จะปรับเปลี่ยนรูปแบบลาย (Moiré pattern) ซึ่งจะส่งผลต่อคุณสมบัติของเฟนอนที่เป็นองค์ประกอบของโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ต์ทำให้คุณสมบัติ บางประการอาจเปลี่ยนตามไปด้วย ในขณะที่พีคของ twisted bilayer ที่ได้จากการ CVD มีค่าใกล้เคียงกับ single layer มาก สาเหตุที่ค่าของพีคของ twisted bilayer ที่ได้ไม่เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงแค่เล็กน้อย น่าจะเกิดจากการที่มี impurities บนพื้นผิวของโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ต์จากการ CVD ทำให้การจัดเรียงตัวของทั้งสองชั้นไม่ยึดติดเป็น bilayer แต่เป็นแบบ monolayer ส่องแพร่ที่เป็นอิสระต่อกันมากช้อนกันแทน

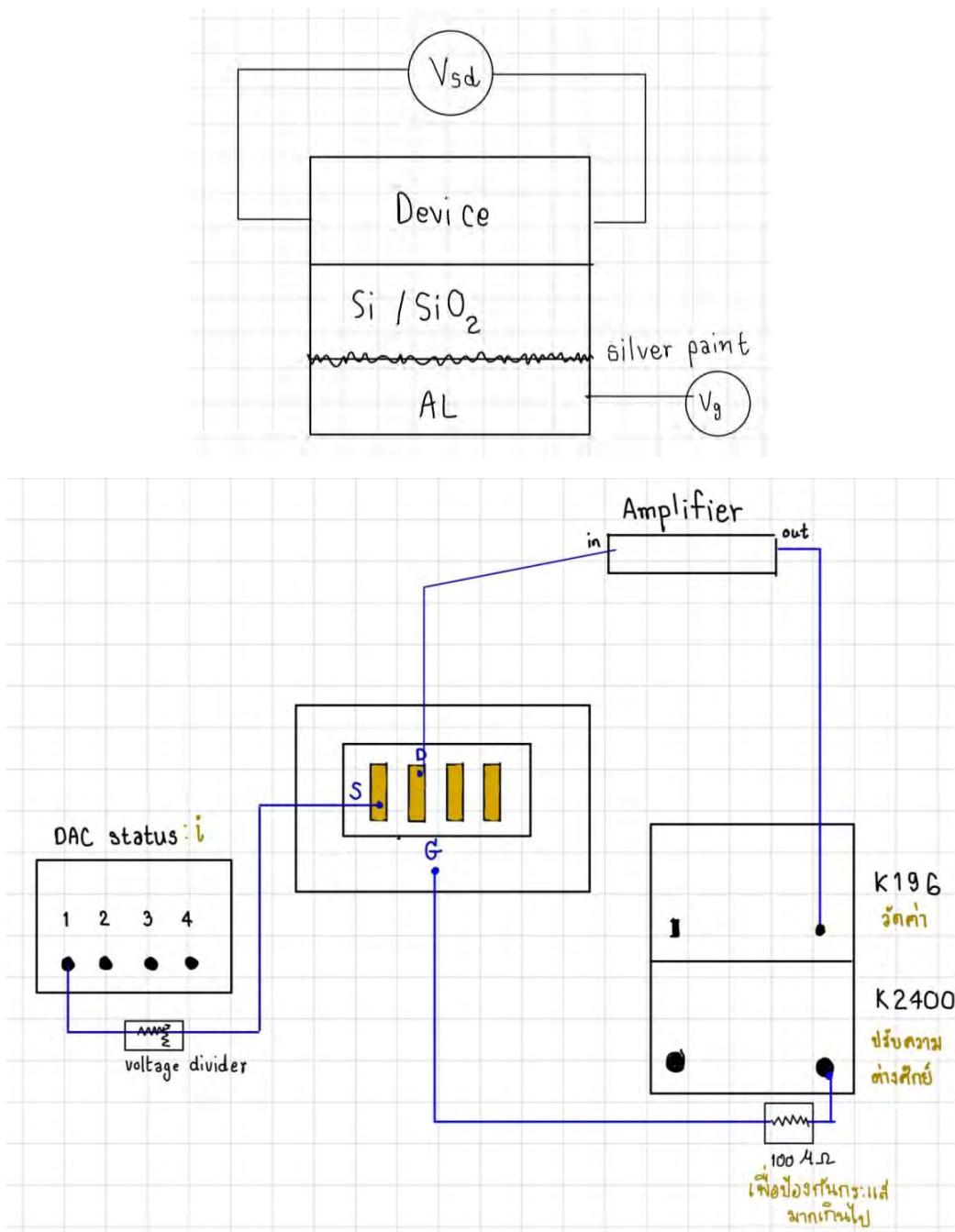
จากนั้นเราต้องการทราบคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของวัสดุเชิงแวนเดอร์วาลส์ที่ประกอบจากโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ต์กับເອກະໂගນอลไบรอนไนไตรด์ คือ ค่าทางไฟฟ้า ซึ่งจำเป็นต้องสร้างเป็นทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าให้ได้ ก่อนที่จะนำไปวัด เนื่องจากชั้นงานของเรา มีขนาดเล็กมากจำเป็นจะต้องละเอียดและระมัดระวังอย่างมากในทุก ขั้นตอน เมื่อสามารถสร้างเป็นทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าได้แล้วจึงนำไปวัดค่าทางไฟฟ้าแบบเป็น gate dielectric ซึ่งค่า mobility ของโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ต์สามารถวัดได้ประมาณ $2.25 \text{ cm}^2/(\text{V.s})$ ที่อุณหภูมิห้องซึ่งต่างจากค่าที่ได้ศึกษาจากงานวิจัยอื่นเป็นอย่างมาก อาจจะเกิดจากการที่คอนแทค (contact) ที่เป็นโมลิบดีนัม (Mo) ยึดติดกับ โมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ต์ไม่ดีจึงทำให้คอนแทคบางส่วนไม่ได้ติดกับโมลิบดีนัมไดซัลไฟฟ์ต์ จะทำให้ค่า conductivity ลดลงไปเยอะกว่าปกติ ส่งผลให้มีการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนั้นน้อยและส่งผลให้ค่า mobility ที่ได้นั้นไม่ดีตามไปด้วย ดังนั้นขอเสนอแนะในการทำการครั้งต่อไปคือการเปลี่ยนวัสดุที่นำมาทำเป็นคอนแทค

បរវត្ថុក្រម

- [1] Huang, Z., Alharbi, A., Mayer, W. et al. Versatile construction of van der Waals heterostructures using a dual-function polymeric film. *Nat Commun* **11**, 3029 (2020).
- [2] Novoselov K. S., Geim A. K., Morozov S. V., Jiang D., Zhang Y., Dubonos S. V., Grigorieva I.V. and Firsov A. A. Electric Field Effect in Atomically Thin Carbon Films Science. (2004), **306**, 666-669.
- [3] Manzeli S., Ovchinnikov D., Pasquier D., Yazyev O. V. and Kis A. 2D transition metal dichalcogenides. *Nature reviews materials* (2017), **2**, 17033.
- [4] Li, Xiao; Zhu, Hongwei (2015-03-01). "Two-dimensional MoS₂: Properties, preparation, and applications". *Journal of Materomics*. **1** (1): 33–44.
- [5] Naik, M. H. & Jain, M. Ultraflatbands and shear solitons in moiré patterns of twisted bilayer transition metal dichalcogenides. *Phys. Rev. Lett.* **121**, 266401 (2018).
- [6] Zuoli He, and Wenxiu Que. Molybdenum Disulfide Nanomaterials: Structures, Properties, Synthesis and Recent Progress on Hydrogen Evolution Reaction. *Applied Materials Today*, **3**, 2016, pp. 23–56.
- [7] Manzeli, S., Ovchinnikov, D., Pasquier, D. et al. 2D transition metal dichalcogenides. *Nat Rev Mater* **2**, 17033 (2017).
- [8] Lee, Changgu, et al. Anomalous Lattice Vibrations of Single- and Few-Layer MoS₂. *ACS Nano*, **4**(5), 2010, pp. 2695–2700.
- [9] Howland, Rebecca, et al. A Practical Guide to Scanning Probe Microscopy. Park Scientific Instruments, 1997.
- [10] B. Radisavljevic, A. Radenovic, J. Brivio, V. Giacometti, A. Kis. Single-layer MoS₂ transistors. *Nature Nanotechnology*, 2011

- [11] Lee YH, Zhang XQ, Zhang W, Chang MT, Lin CT, Chang KD, Yu YC, Wang JT, Chang CS, Li LJ, Lin TW. Synthesis of large-area MoS₂ atomic layers with chemical vapor deposition. *Adv Mater.* 2012 May 2;24(17):2320-5.
- [12] R. Frisenda et al. Recent progress in the assembly of nanodevices and van der Waals heterostructures by deterministic placement of 2D materials. *Chemical Society Reviews* **47**(1) (2017)
- [13] Ioannis Paradisanos, Shivangi Shree, Antony George, Nadine Leisgang. Controlling interlayer excitons in MoS₂ layers grown by chemical vapor deposition. *Nature Communications* **11**, Article number: 2391 (2020)

ภาคผนวก



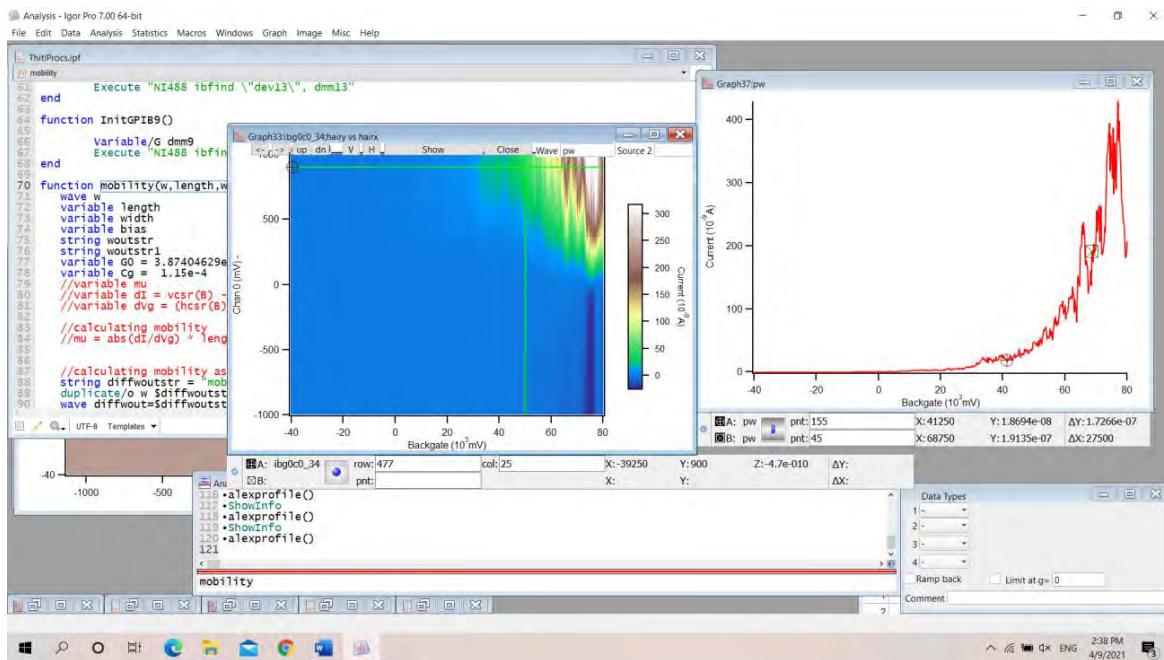
รูปที่ 57 แสดงวงจรอย่างง่ายในการวัดค่าทางไฟฟ้าของทรานซิสเตอร์โนลิบเด็นมั่นไดซัลไฟฟ์



รูปที่ 58 แสดงตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวัดจริง



รูปที่ 59 แสดง probe หัวสีที่ใช้ในการวัดและกล้องจุลทรรศน์ที่ทำให้วาง probe ลงไปบนคอนแทคได้ง่ายขึ้น เนื่องจากขั้นตอนที่ใช้ วัดมีขนาดที่เล็กมากๆ



รูปที่ 60 แสดงตัวอย่างโปรแกรม Igor ที่ใช้วัดค่าทางไฟฟ้า